



股票代號

7730

暉盛科技股份有限公司

上市前業績發表會

主辦承銷商  **福邦證券**
Grand Fortune Securities

主講者：許嘉元 總經理

免責聲明

本簡報及同時發佈之相關訊息乃建立於本公司目前從各項來源所取得之資訊，部分資訊可能受未來不確定性因素影響，產生風險與不確定性，造成預期狀況與實際狀況有所差異，若實際狀況與本公司目前對於未來前景的前瞻性說明迥異，且有變更或調整時，本公司不負有更新或修正之責任。

本公司並未作任何明示或暗示聲明或保證，請勿仰賴本資料中所呈現或所包含之資訊之正確性、公正性或完整性。

大綱 AGENDA

- ▶ 公司簡介
- ▶ 主要產品與關鍵應用市場
- ▶ 產業概況與競爭優勢
- ▶ 營運實績
- ▶ 公司治理與企業社會責任

公司簡介

暉盛科技股份有限公司

股票代號：7730

Nano Electronics and Micro System Technologies, Inc.

成立時間	2002年6月
總部	台南市安南區
資本額	NTD 3.46億元
董事長	宋俊毅
總經理	許嘉元
主要業務	研發先進電漿技術為主軸，以尖端技術服務為宗旨，發展各式電漿設備，可針對各類材料進行表面清潔、改質、蝕刻、鑽孔製程。



經營理念

誠信
為本

品質
承諾

夥伴
共榮

專業
卓越

持續
創新

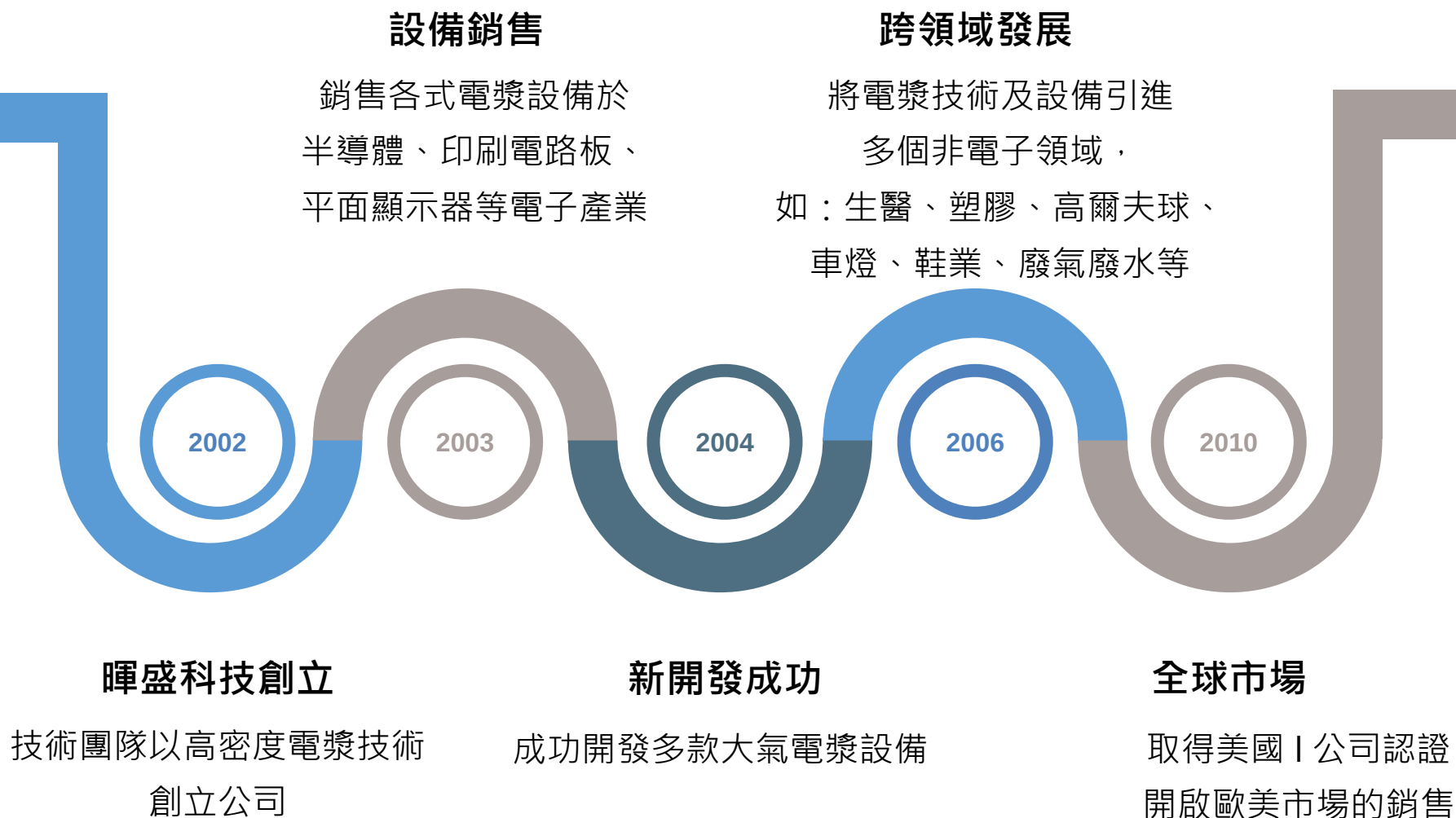
願景

成為全球最先進、最大的電漿表面處理技術及電漿設備製造服務業者
結合智慧生產，打造最具競爭力的團隊

長期使命

作為各先進產業中，長期且值得信賴的技術提供者

公司沿革



公司沿革



市場分佈_全球佈局策略



營運策略

- 全球佈局、專業研發
- 成為全球電漿設備領導廠商之一

關係企業組織圖



公司經營團隊

許嘉元 總經理
成功大學化工系博士
專長：電漿技術
產業年資：25年



宋俊毅 董事長
臺灣科技大學電子系
專長：電子工程
產業年資：40年



蔡郁仁
財會部 經理
政治大學會研所 碩士
專長：財務會計
產業年資：26.5年

邱冠陸
行銷部 部經理
成功大學航太系碩士
專長：國際貿易
產業年資：25年



符永豪
生產部 部經理
成功大學資源系碩士
專長：電漿技術、系統設計
產業年資：25年

梁國超 博士
研發部 資深經理
成功大學化工系博士
專長：電漿、半導體
產業年資：25年

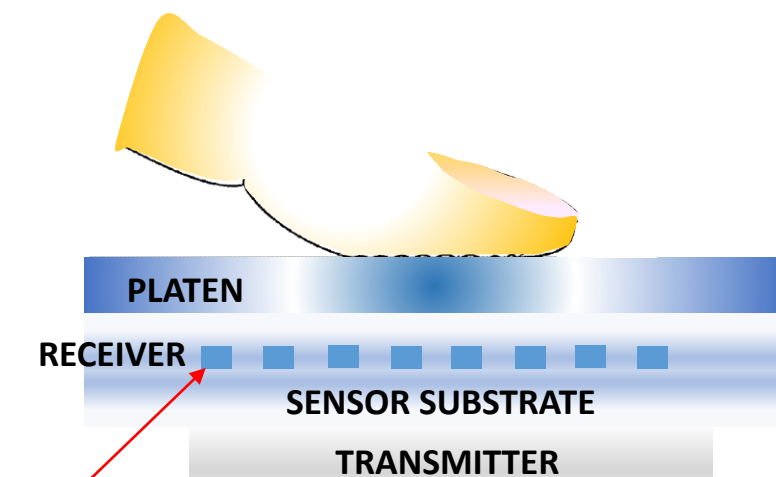


主要產品與關鍵應用市場

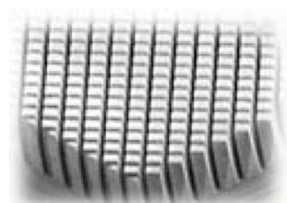
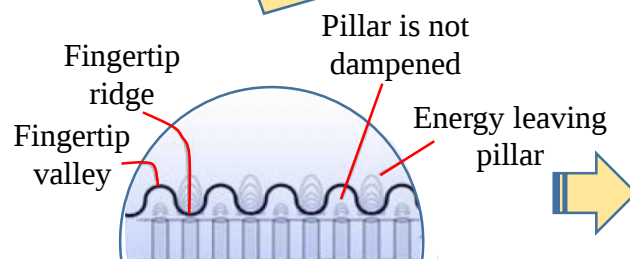
主要產品與關鍵應用市場

產業鏈	半導體				IC載板	印刷電路板	新能源與環保
產業應用	指紋辨識晶片	晶圓製造	晶圓再生	先進封裝	覆晶基板	多層、軟性、 高頻PCB	氫能、固態廢棄 物與廢氣處理
關鍵製程	PVDF、PZT Polarization	Grinding Thinning Dicing	Wafer Reclaim	FOWLP FOPLP Hybrid Bonding	ABF(all dry)& Glass Substrate	ABF、BT、FR4 & FCCL	Thermal methane cracking for hydrogen& High- temp cracking
關鍵技術	常壓電漿極化	ICP-RIE 電漿蝕 刻系統	ICP-RIE 電漿蝕 刻系統	ICP-RIE 電漿蝕刻系統 Hybrid Bonding(混合 鍵合技術) - 大氣電漿 處理技術	ICP-RIE 電漿蝕 刻系統	RIE 電漿蝕刻系 統	高效電漿火焰技術
應用設備	電漿極化機	電漿清洗機 / 電漿去膠渣機 / 電漿蝕刻機	電漿蝕刻機	電漿清洗機 / 電漿蝕刻機	電漿清洗機 / 電漿去膠渣機 / 電漿蝕刻機 / 電漿鑽孔機	電漿清洗機 / 電漿去膠渣機	高效電漿火焰處理 設備
關鍵專利	1. 壓電材料極化 設備 2. 卷對卷式電漿 去膠渣機	1. 感應耦合電漿蝕 刻設備及其多迴 圈式電極 2. 自動化線上電漿 製程系統	1. 感應耦合電漿蝕 刻設備及其多迴 圈式電極 2. 自動化線上電漿 製程系統	1. 感應耦合電漿蝕刻設 備及其多迴圈式電極 2. 自動化線上電漿製程 系統 3. 電漿晶圓清潔機及使 用其清潔晶圓的方法 4. 電漿氧化還原裝置及 方法	1. 感應耦合電漿蝕刻設 備及其多迴圈式電極 2. 自動化線上電漿製程 系統 3. 電漿晶圓清潔機及使 用其清潔晶圓的方法	1. 自動化線上電漿製 程系統 2. 卷對卷式電漿去膠 渣機	1. 氣體分解裝置(一) 2. 氣體分解裝置(二) 3. 氣體分解裝置(三)

主要產品_半導體_指紋辨識



SENSOR CIRCUIT

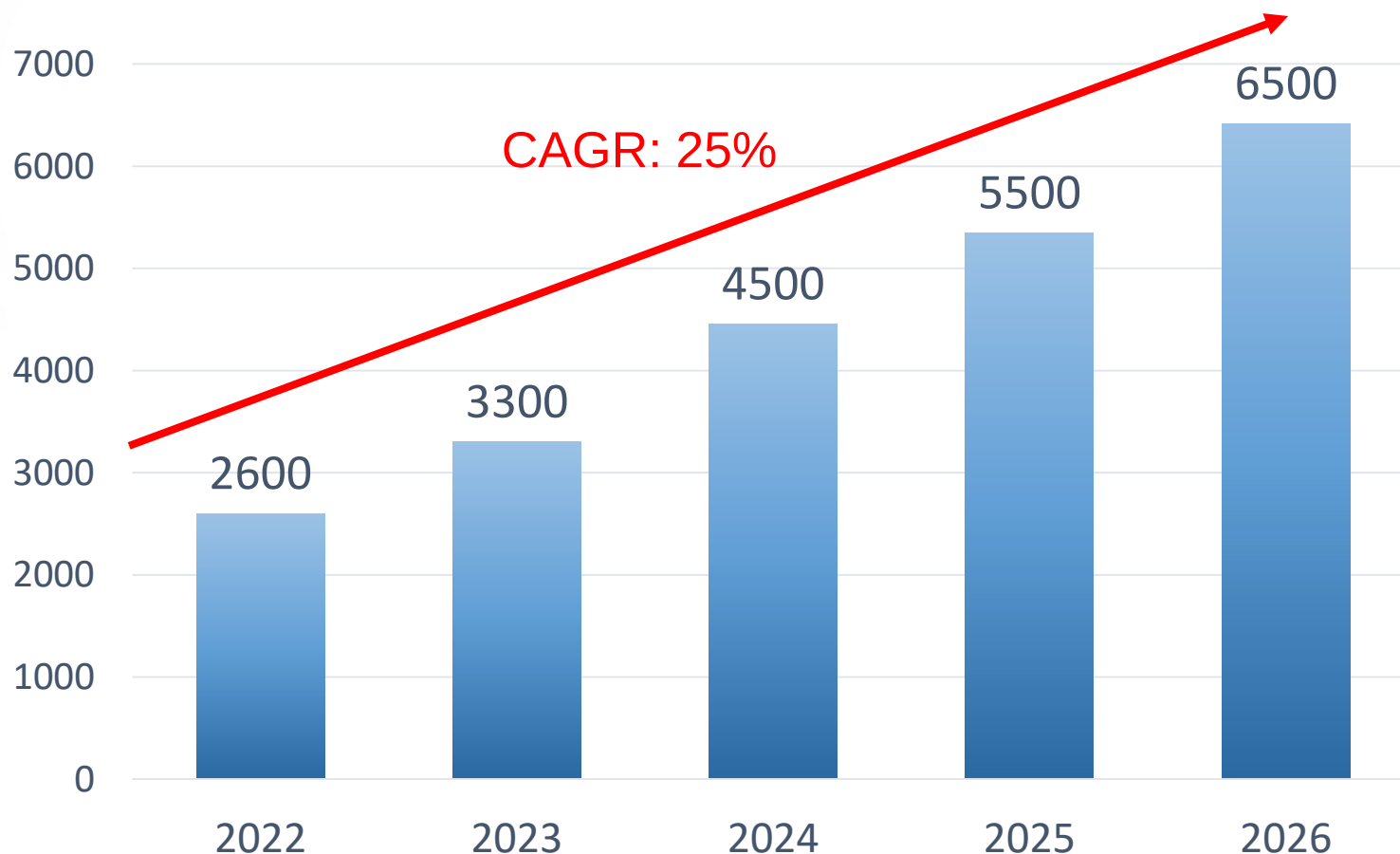


Plasma Polarization
(電漿極化機)



主要產品_半導體_指紋辨識

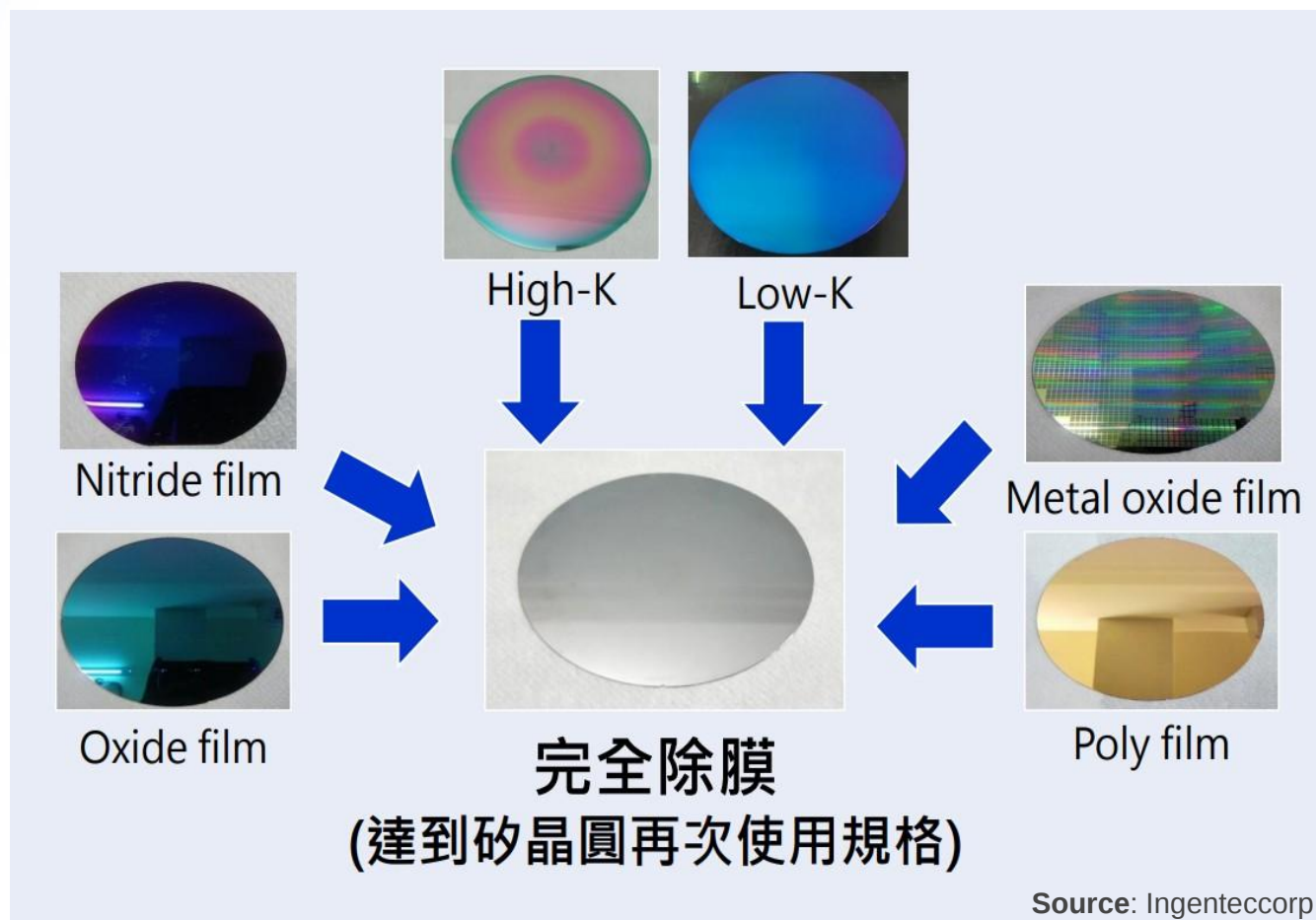
全球指紋辨識晶片成長數量預測(單位:萬顆)



資料來源: 業界訪談

- **2022需求：2600萬顆。**
(主要是韓系手機,中系手機次之,日系手機少量)
- **2023需求：3300萬顆。**
(主要是韓系手機,美系手機次之,中系日系手機少量)
- **2024需求：4500萬顆。**
(主要是韓系手機,中系美系手機次之,日系手機少量)
- **2025年與2026年預估都會有20%以上的成長。**

主要產品_半導體_晶圓再生

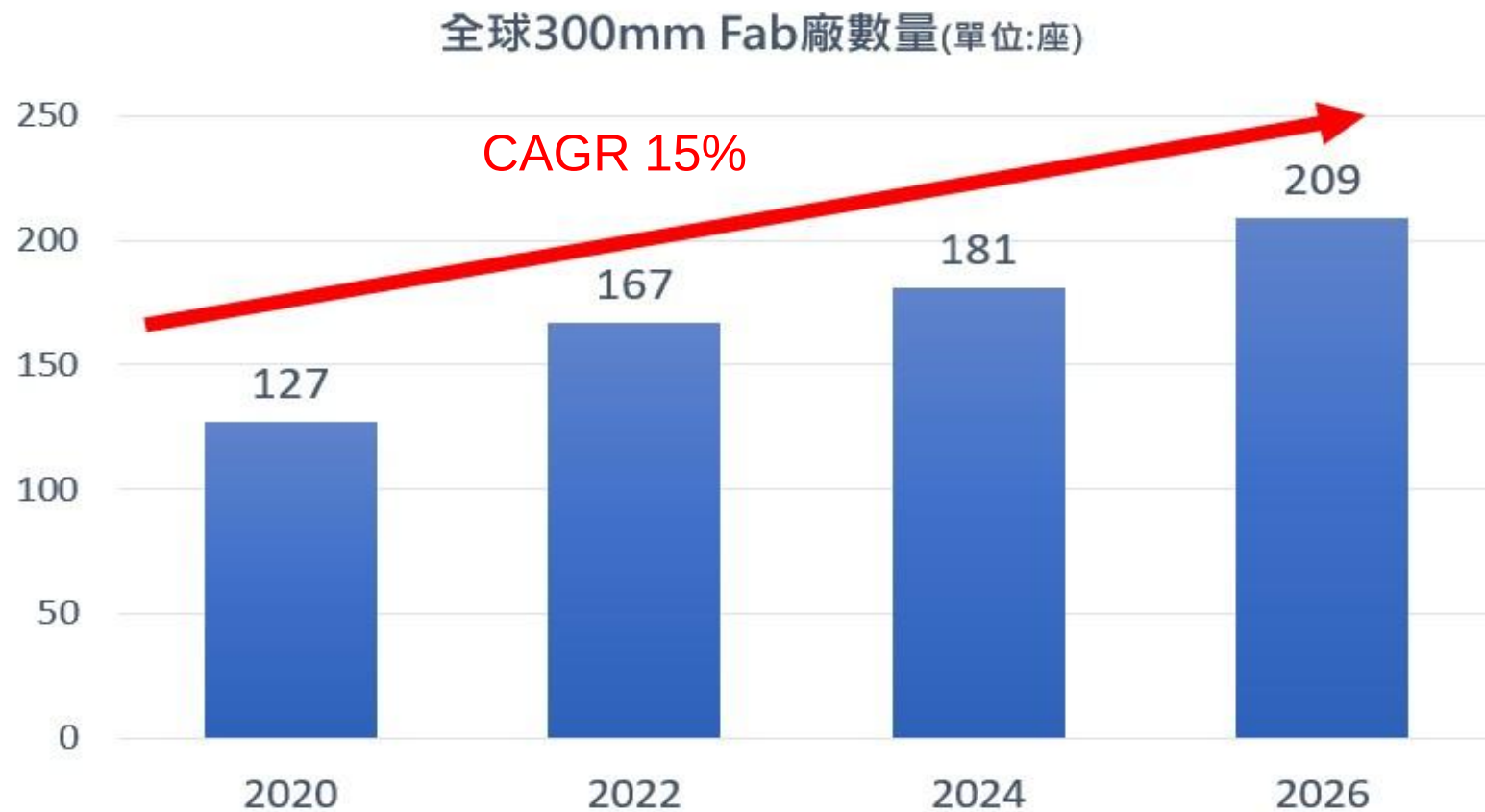


- ICP RIE蝕刻晶圓表面的薄膜,取代濕式化學清洗去膜製程,可減少化學藥品/純水使用成本及廢水處理成本。
- 可去除Nitride, Poly-Si, SiO₂, Low/High K 薄膜。
- 控片除膜率可從60%提高至100%。



圖片來源:晶呈

主要產品_半導體_晶圓再生



資料來源:SEMI

- 每座 300mm Fab 預估4萬片月產能
- 晶圓再生需求大於二萬片/月。
- 2024年全球市場 300mm Fab 達到 181座。
- 全球晶圓再生需求>300萬片/月
- 製程越先進,擋控片用量越高,加上 ESG 要求下,晶圓再生除膜需求會越來越高。

主要產品_半導體_先進封裝 (FOWLP/FOPLP)

FOWLP / FOPLP

➤ RDL First

- **Underfill** & Molding
- De-bond

➤ Chip First

Wafer/Panel **ABF Etching**

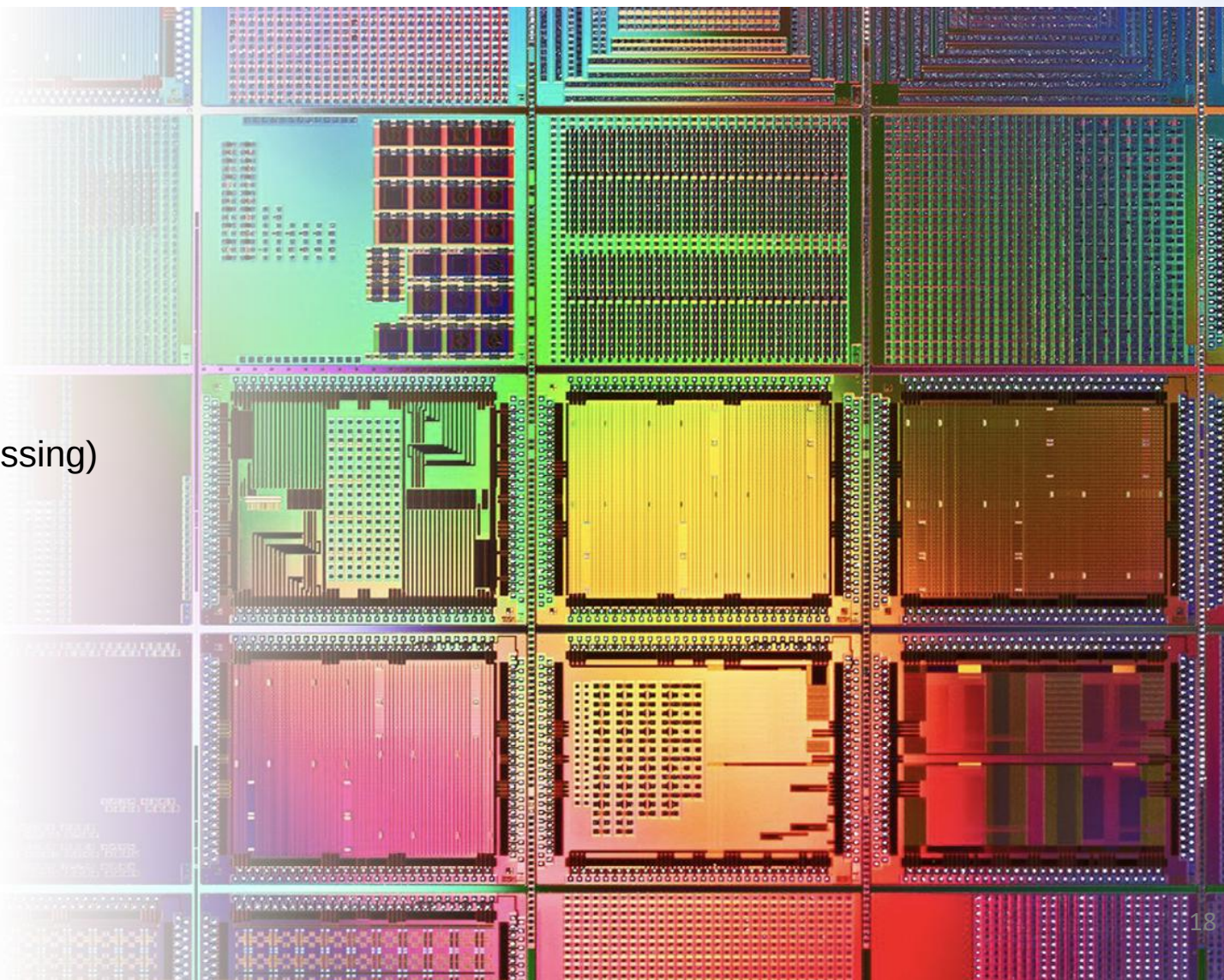
- 高速蝕刻 (High Speed Etching)
- 無損傷鋁 pad 處理 (Non-damage Al Pad Processing)
- 孔型垂直蝕刻 (Vertical Hole Etching)
- 無擴孔技術 (No Undercut)

Plasma descum before sputtering

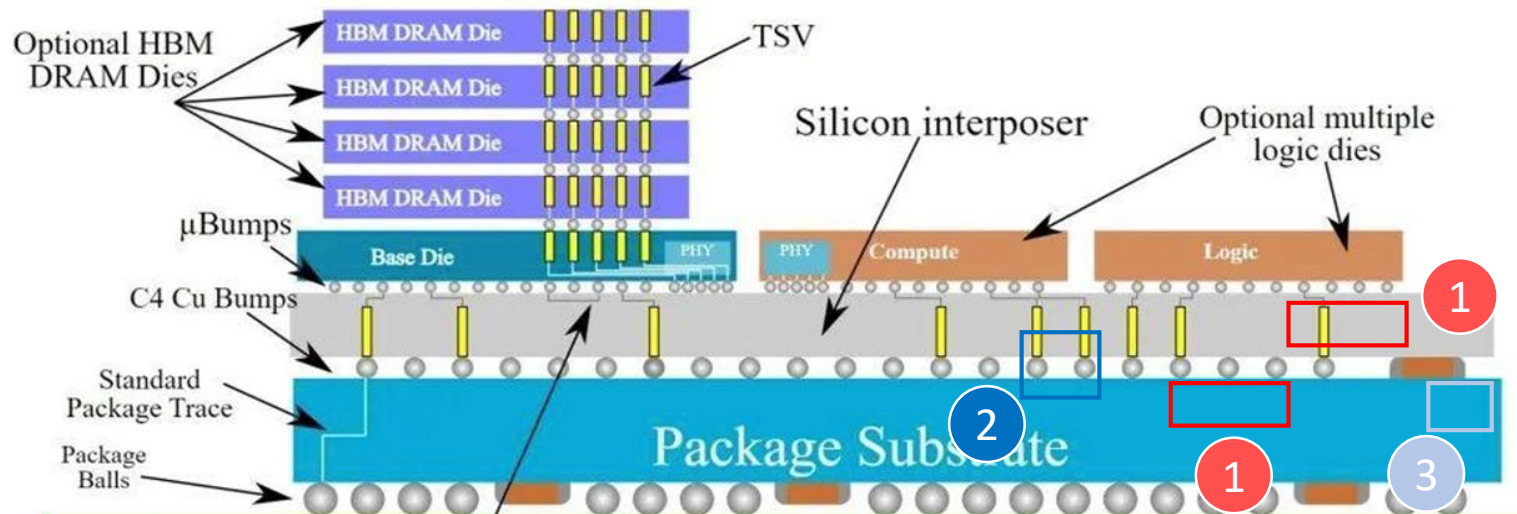
➤ Glass Core

TGV (Through Glass Via) 電鍍前清潔

- 玻璃穿孔清潔 (Glass Via Cleaning)
- 電鍍前處理 (Pre-Electroplating Treatment)



主要產品_半導體_先進封裝 (WLP)



Source : WikiChip: Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS) - TSMC



1

Underfill_Plasma Cleaning
(電漿清洗機)



2

TSV_Plasma Etching
(電漿蝕刻機)

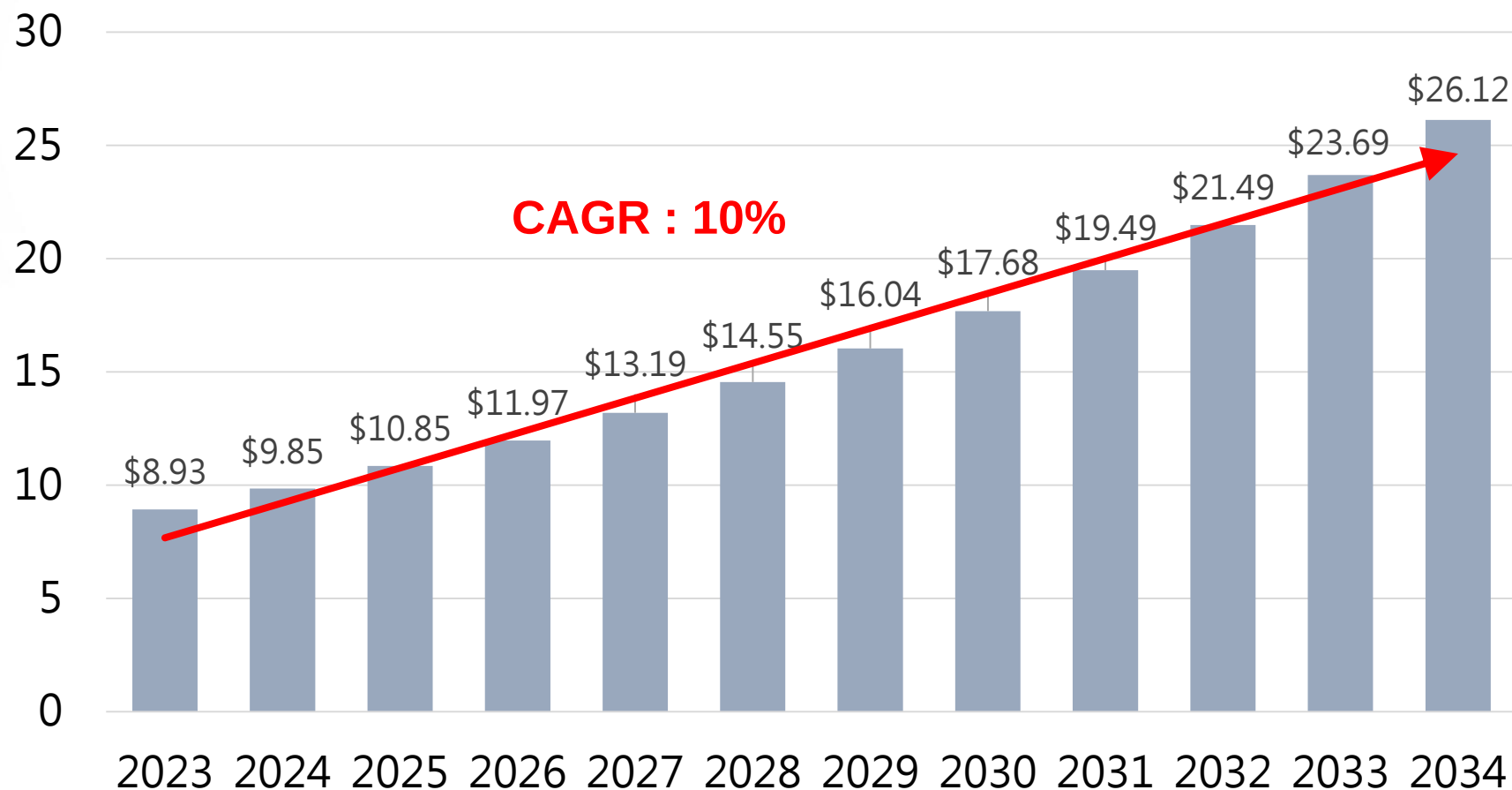


3

Substrate_Plasma Cleaning
(電漿清洗機)

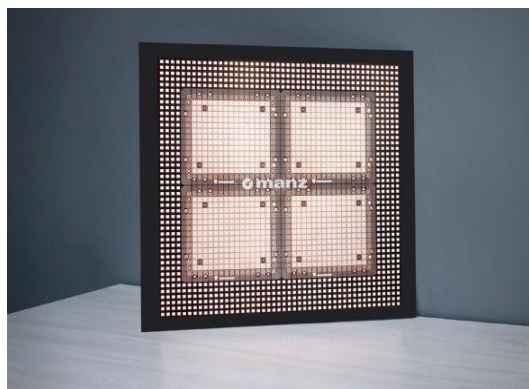
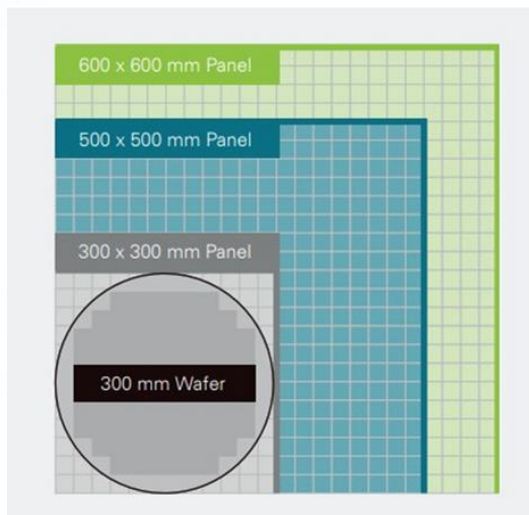
主要產品_半導體_先進封裝 (WLP)

Wafer Level Packaging Market Size 2023-2034 (USD Billion)



Source:
<https://www.towardspackaging.com/insights/wafer-level-packaging-market-sizing>

主要產品_半導體_先進封裝 (FOPLP)



Source : Manz

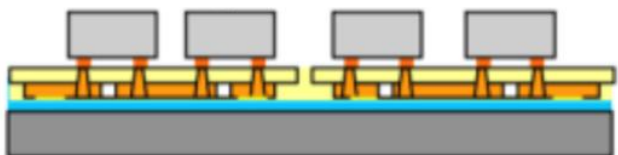
Apply release layer on carrier



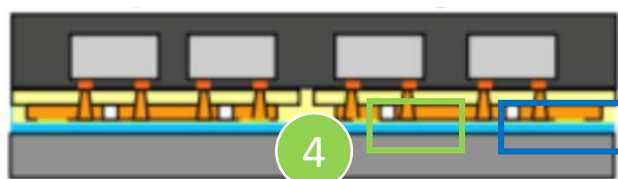
RDL (e.g. thin film, PCB based, ...)



Die assembly on carrier



Wafer / panel overmolding



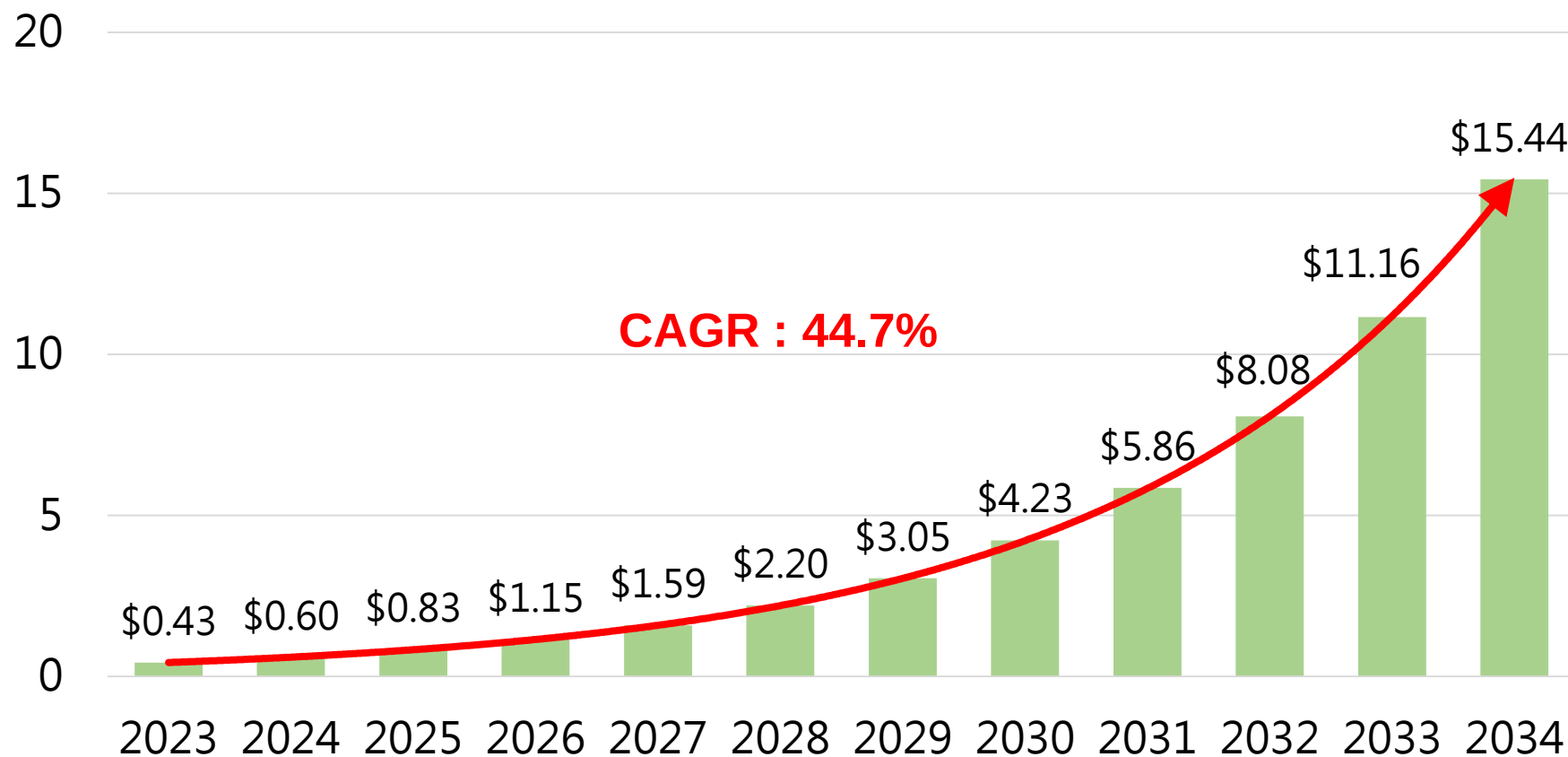
Carrier release, balling, singulation



- 1 Underfill_Plasma Cleaning (電漿清洗機)
- 2 De-Bond_Plasma Cleaning (電漿清洗機)
- 3 Before Sputter_Plasma Descum (電漿去膠渣機)
- 4 Glass Recycle_Plasma Cleaning (電漿清洗機)

主要產品_半導體_先進封裝 (FOPLP)

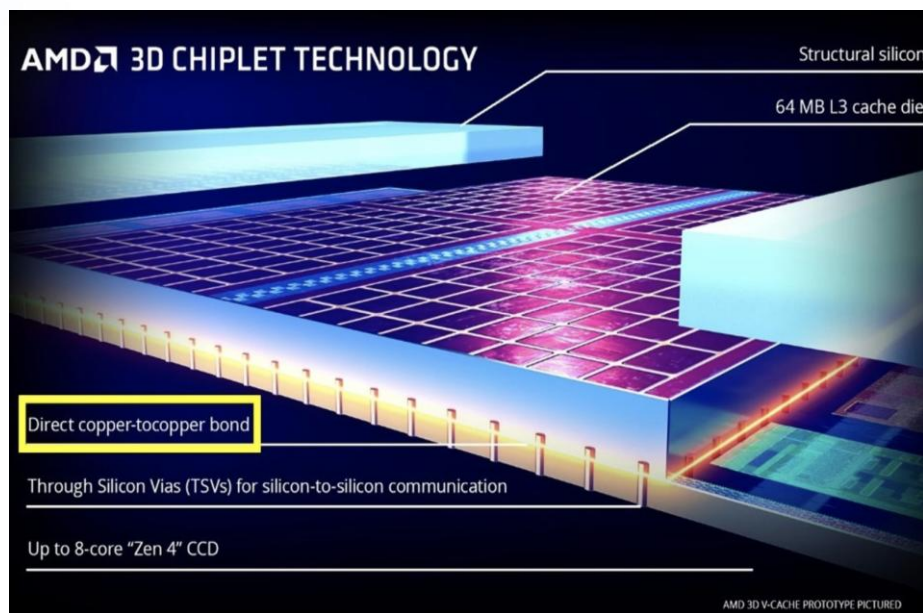
Panel Level Packaging Market Size 2023-2034 (USD Billion)



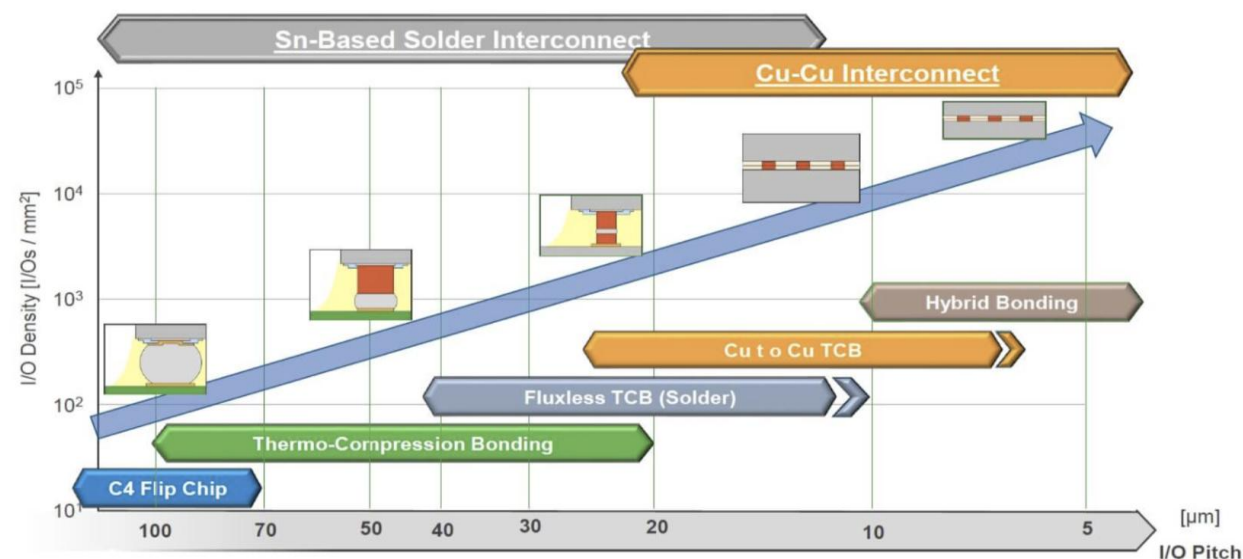
Source:
<https://www.towardspackaging.com/insights/panel-level-packaging-market-sizing>

主要產品_半導體_先進封裝 (Hybrid Bonding)

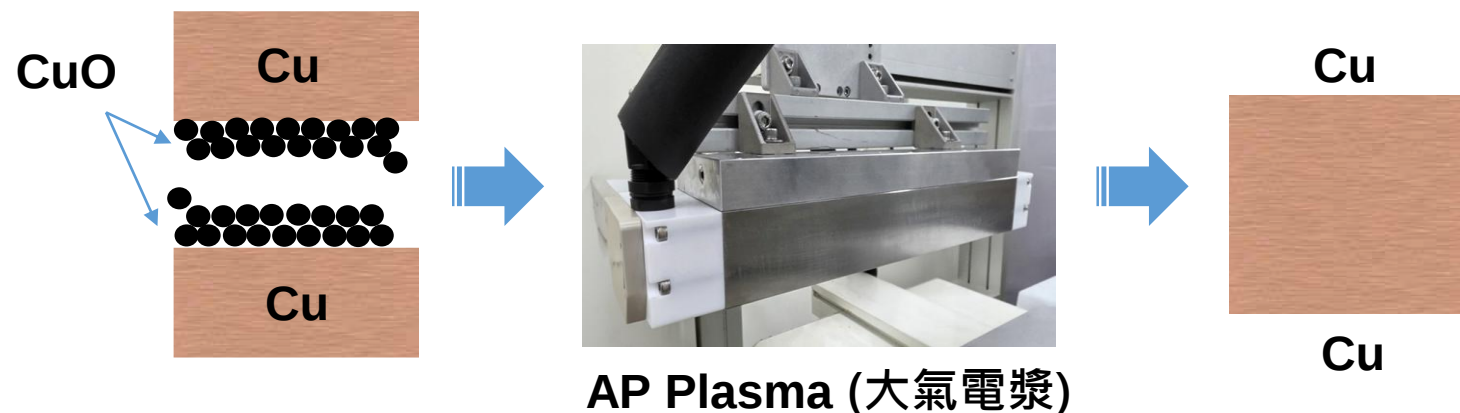
Hybrid Bonding是將晶片連接的技術，透過金屬（如銅）和氧化物鍵合，最大優勢就是**降低凸塊的間距並縮小接點間距**，由此可以在相同的面積下提升連接密度，也就達到更快的傳輸速度並且降低能耗。



Source: AMD



Source: K&S



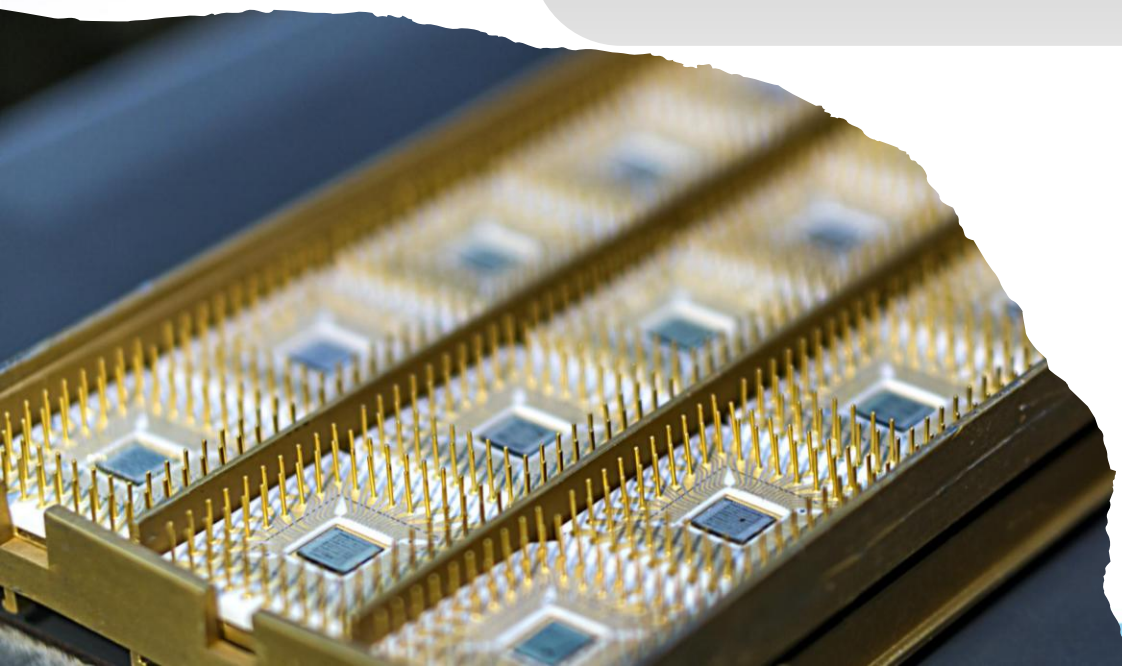
主要產品_半導體_先進封裝 (Hybrid Bonding)

電漿技術的挑戰

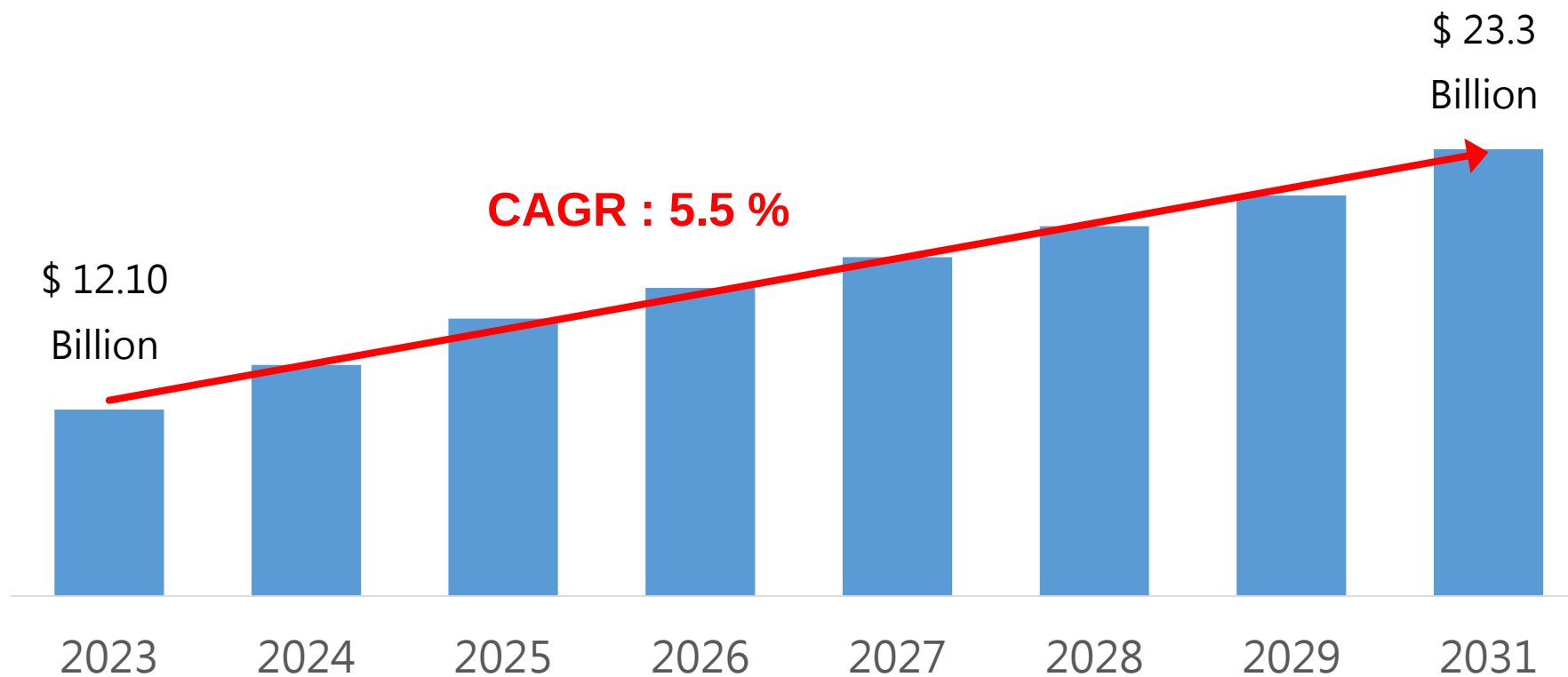
挑戰項目	技術難度
超精細 Pitch (< 2 μ m) 電漿去氧化	☆☆☆☆
低溫表面活化 (< 300°C)	☆☆☆
降低 Cu-Cu 鍵合電阻	☆☆☆☆
大面積(處理幅寬320mm)晶圓均勻處理	☆☆☆☆☆
減少電漿蝕刻對材料的影響	☆☆☆



電漿技術發展，將朝向**更高精度、更低溫、更均勻、更低損傷及大面積**的方向發展，這也是目前 TSMC、Intel、三星等半導體大廠在 3D IC 與 Chiplet 研發上的關鍵技術競爭點。



主要產品_半導體_先進封裝 (Hybrid Bonding)

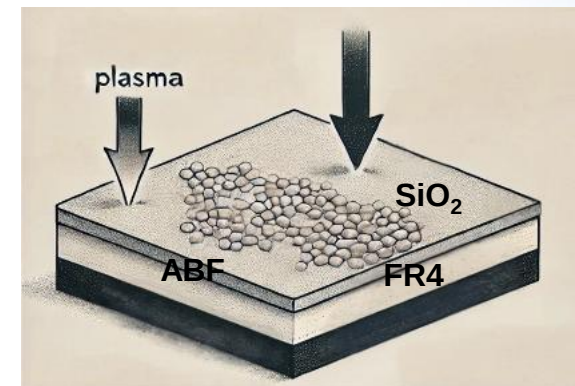


Source:
<https://www.verifiedmarketresearch.com/product/hybrid-bonding-technology-market/>

主要產品_半導體_IC 載板 (ABF)

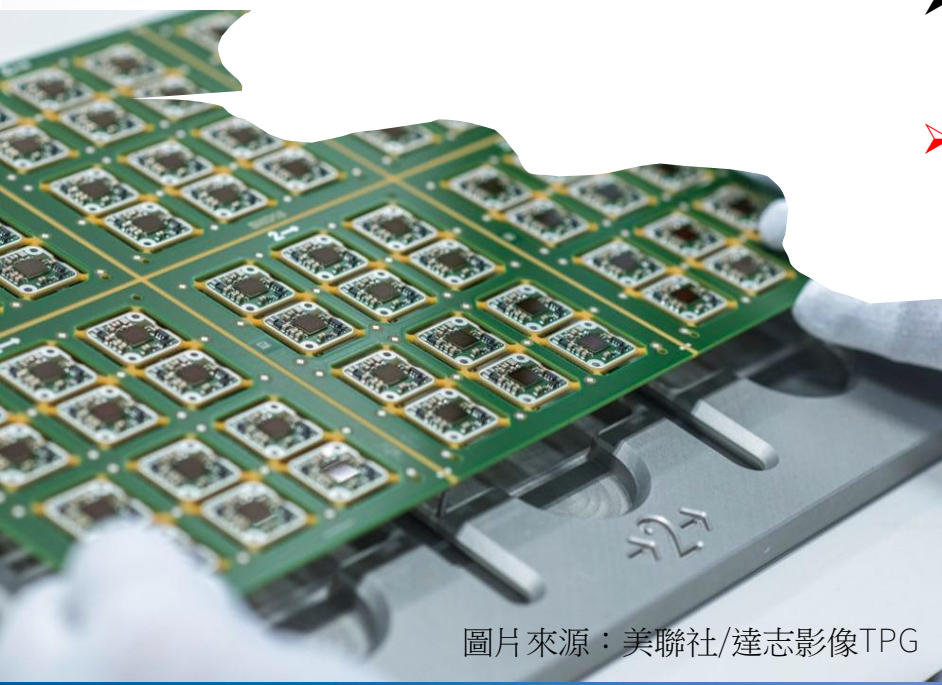
ABF載板乾式製程技術

- ABF載板是一種高密度積層基板 (Build-up Substrate) , 廣泛應用於 高階封裝 (如 CPU 、 GPU 、 AI 晶片) 中。主要特性包括：絕緣性能優異、低熱膨脹係數 (CTE)、適用於先進封裝技術：如 Flip-Chip 、 Fan-out 、 2.5D/3D IC 封裝等。



- ABF 的主要成分包含環氧樹脂 (Epoxy Resin)及SiO₂ 填料 (Silica Filler) , SiO₂主要控制介電常數 (Dk) 和熱膨脹係數 (CTE) 。
- SiO₂ 含量影響蝕刻速率與選擇性 , 而為確保 ABF 載板的高效蝕刻 , 提高製程良率 , 並滿足 5G 、 AI 高速運算封裝需求 , 所使用的電漿系統必須具有以下特性：

高蝕刻速率 (Etch Rate)
高蝕刻選擇性 (Etch Selectivity)
可控的表面粗糙度 (Surface Roughness)



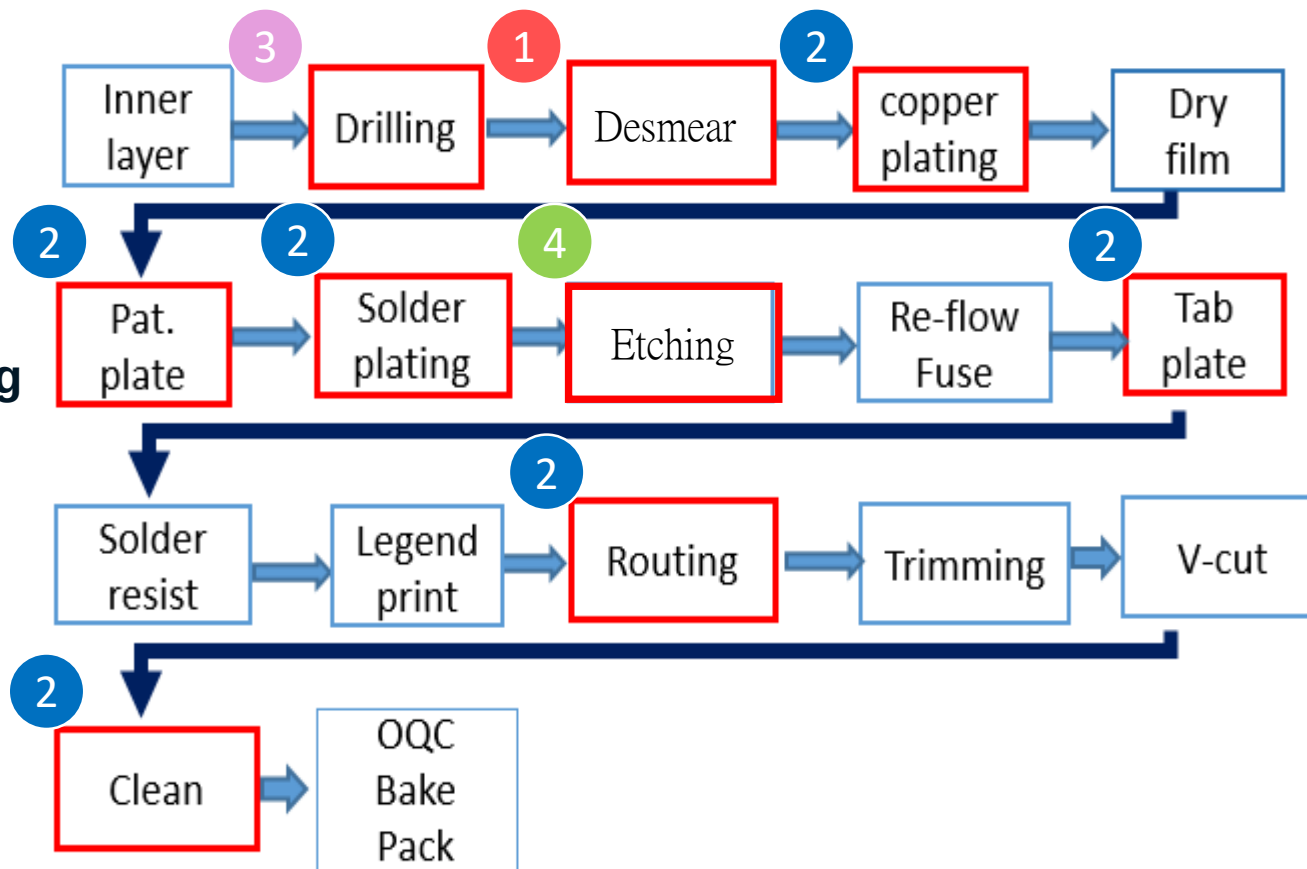
主要產品_半導體_IC 載板 (ABF)



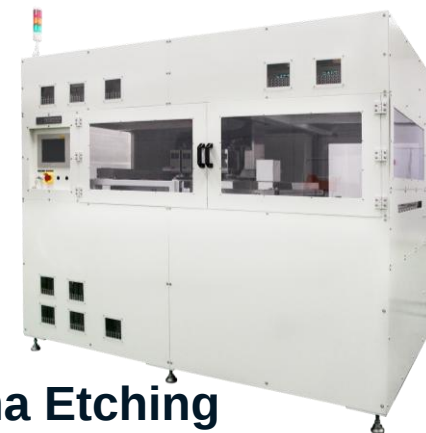
2 Plasma Cleaning
(電漿清洗機)



3 Plasma Driling
(電漿鑽孔機)



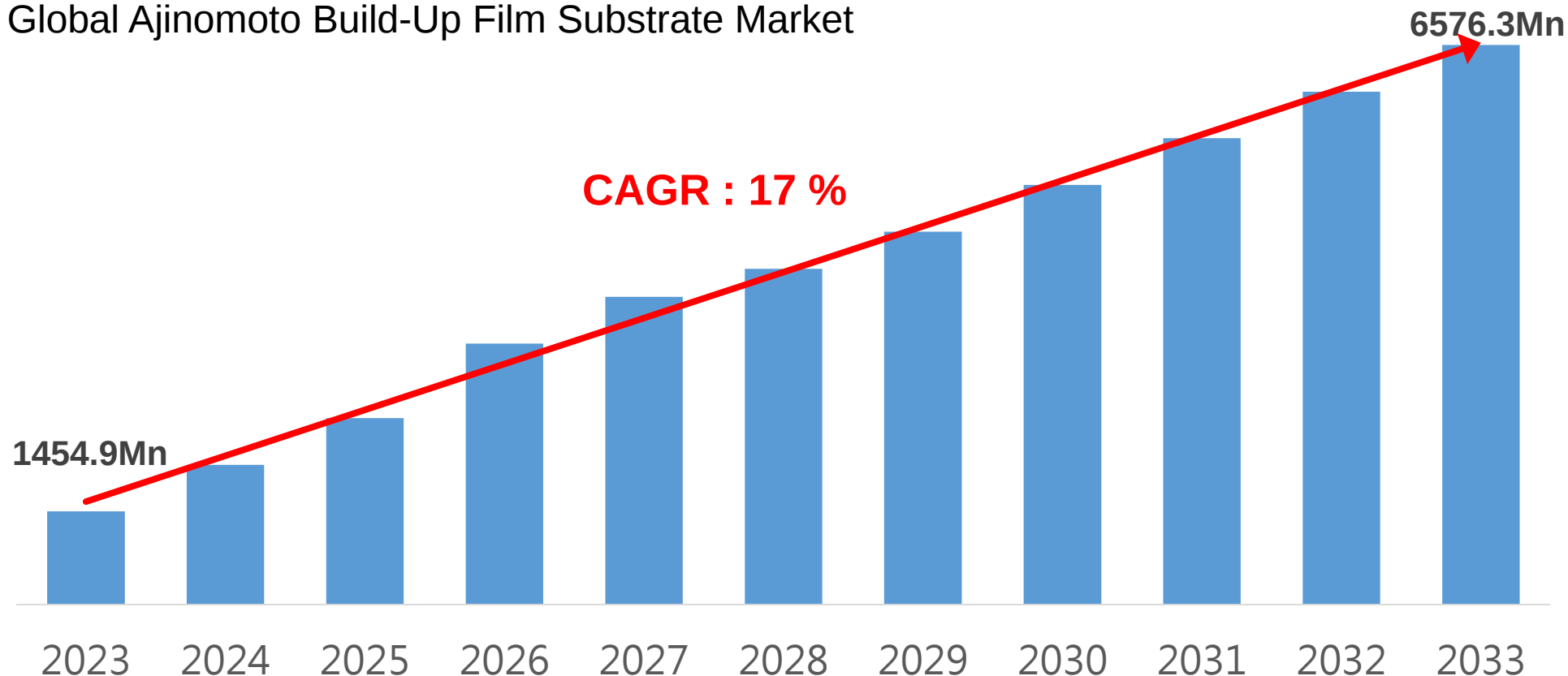
1 Plasma Desmear
(電漿去膠渣機)



4 Plasma Etching
(電漿蝕刻機)

主要產品_半導體_IC 載板 (ABF)

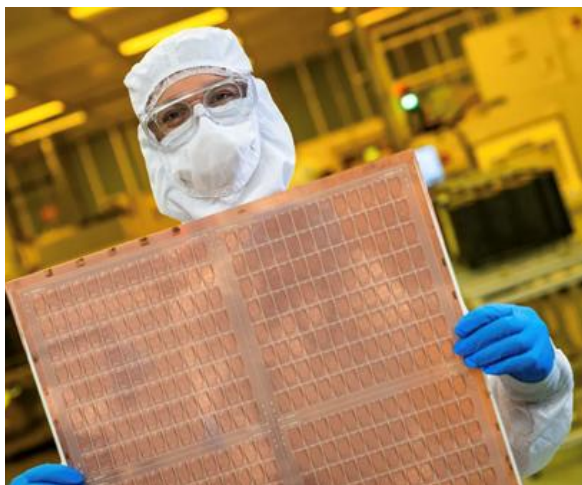
Global Ajinomoto Build-Up Film Substrate Market



Source:
<https://www.sphericalinsights.com/press-release/ajinomoto-build-up-film-substrate-market>

主要產品_半導體_IC 載板 (Glass)

- **玻璃基板優勢**：玻璃基板提供更高穩定度和耐高溫性能，減少50%圖案變形，有助於提高生產效率和降低成本。
- **應用領域**：玻璃基板技術將主要應用於需要大量封裝的產業，如資料中心、AI和繪圖處理晶片。



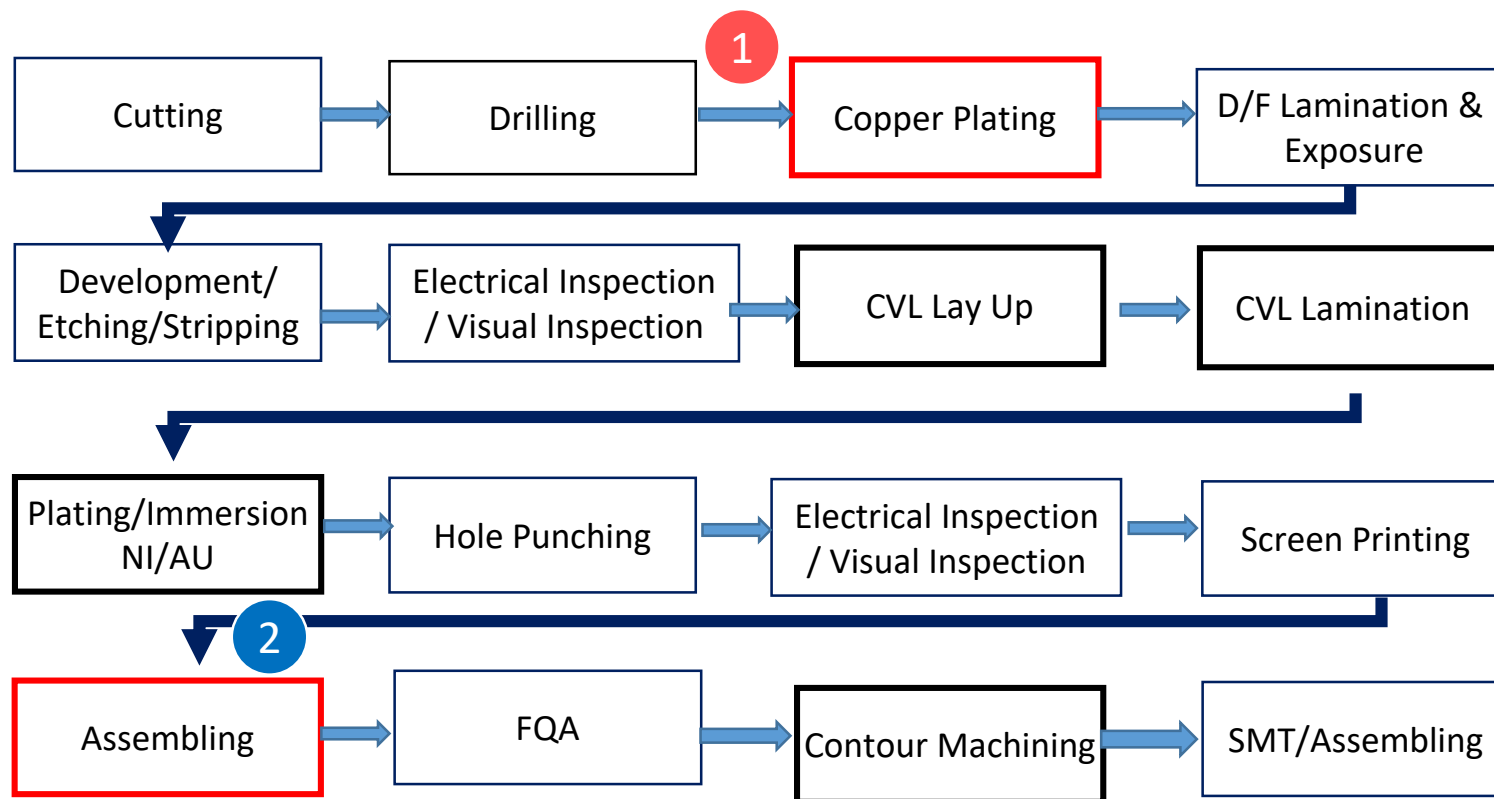
Source: Intel

Plasma Cleaning (電漿清洗機)



Source: Intel

主要產品_印刷電路板



- 1 Plasma Desmear
(電漿去膠渣機)
- 2 Plasma Cleaning
(電漿清洗機)

主要產品_新能源與環保_高效電漿火焰

高效電漿火焰處理設備

➤ 技術概要

- 高溫電漿 ($>2000^{\circ}\text{C}$) , 高效分解有害氣體與溫室氣體
- 甲烷裂解產氫 ($\text{CH}_4 \rightarrow \text{H}_2$) , 支持新能源發展

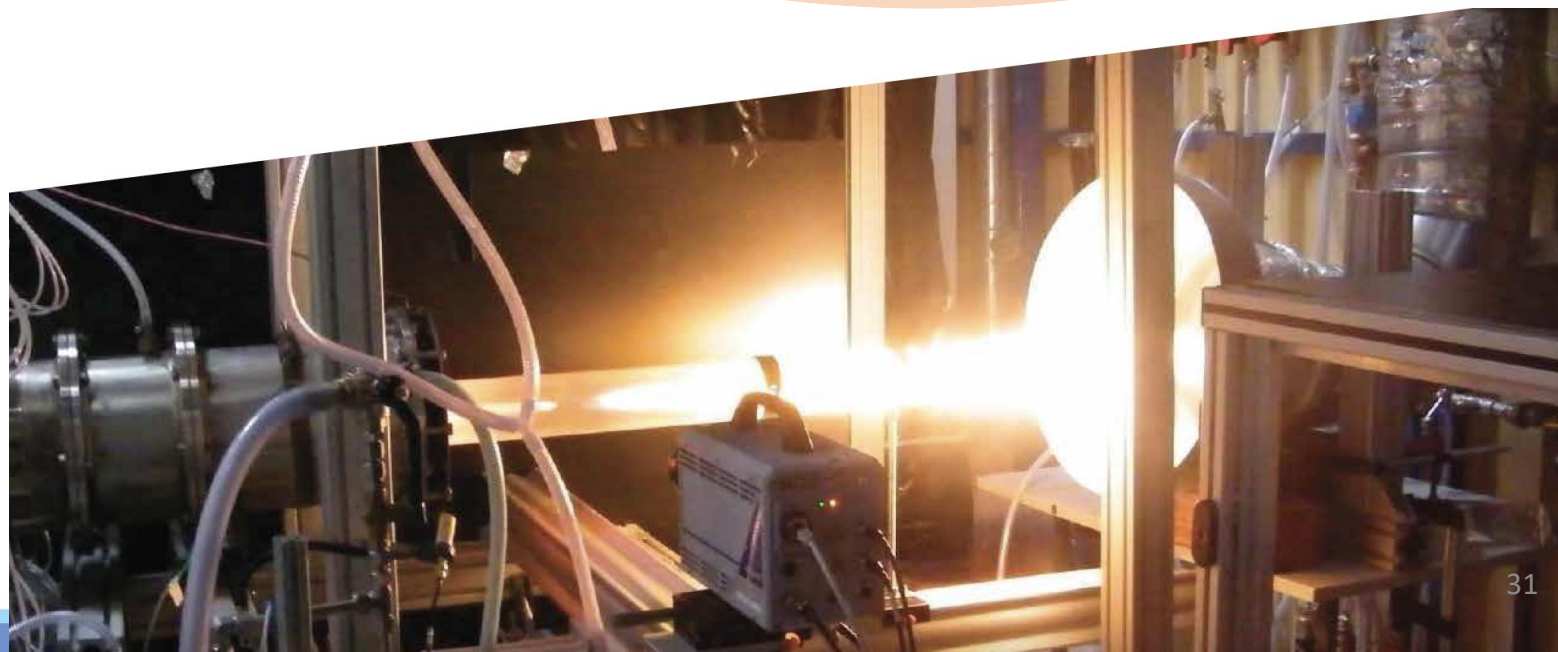
➤ 核心特性

- 無電極放電 (延長設備壽命)
- 高效氣體裂解 (降低環境污染)
- 熱能回收 (提升能源利用率)

➤ 主要應用

- 溫室氣體減排 (CF_4 、 NF_3 、 SF_6 等)
- 化石燃料轉化 (甲烷 $\rightarrow$ 氫氣 H_2)
- 半導體 & 新能源應用 (支持 ESG)

高效電漿火焰處理技術助力
碳中和與潔淨能源轉型，推
動永續發展



產業概況與競爭優勢

產業概況_電漿技術核心地位

應用範疇

- 表面改質、清潔、蝕刻、去膠
- 提高良率、提升製程精度，支援高密度封裝

關鍵製程優勢

- 乾式、低化學品使用
- 能耗低、環保性佳，符合 ESG 需求
- 奈米級精度，支援最新節點與封裝技術

市場機會

- 高價值製程：ABF、WLP、PLP、Hybrid Bonding
- 電漿技術成為先進晶圓製程的必備解決方案

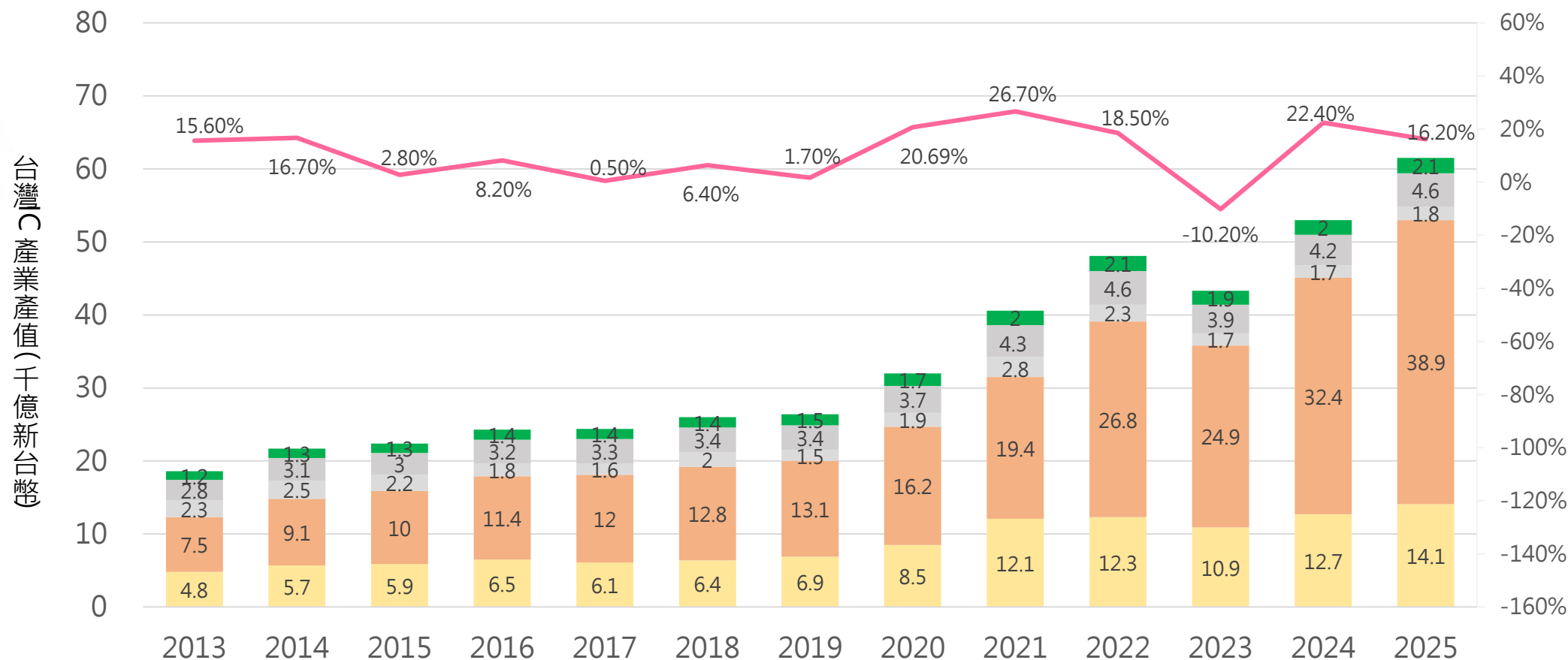
電漿技術憑藉高環保、高精度優勢，在先進製程與新品應用中扮演關鍵角色，市場前景顯著。

台灣IC產業產值(各次產業)統計

2025年晶圓代工產值為3.9兆元

2025年IC各次產業產值皆呈正成長態勢，其中積體電路製造仍為台灣IC產業的核心，其中**晶圓代工**展現顯著成長動能，**年成長20.1%**。

■ IC設計業 ■ 晶圓代工 ■ 記憶體及其他製造 ■ IC封裝業 ■ IC測試業 — 台灣IC產業總產值年成長率



競爭優勢 (一) _專業電漿技術研發團隊

專精跨領域技術

➤ 專業團隊

- 研發團隊由多位在電漿技術領域的專家組成，擁有豐富的行業經驗和技術背景。

➤ 持續技術精進與創新突破

- 團隊致力於推動電漿技術的創新，探索新的應用和解決方案。

➤ 成為世界知名大廠供應鏈

- 本公司已從傳統設備銷售轉向「製程即服務」營運架構，提供材料測試、製程驗證、技術升級等增值服務。
- 與世界龍頭企業合作共同開發特規製程，並可藉由Tier-1客戶推薦至供應鏈。



競爭優勢 (二) _電漿技術平台發展

核心技術平台持續深化

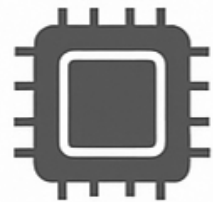


- 高密度電漿源與模組研發，強化原創性與技術壁壘。
- 優異製程能力(蝕刻速度、均勻度、蝕刻選擇性、表面粗糙度、處理面積)展現。
- 跨材料 (ABF、玻璃、矽、碳化矽等) 與多製程 (蝕刻、清洗、裂解等) 整合能力。
- 具模組化與高擴展性的技術架構，支援異質平台與高階應用。

創新模式與智慧化整合



- 製程即服務架構，整合模組與參數驗證。
- AI 製程優化平台，提升製程效率與預測能力。
- ERP、CRM、PLM 系統整合與部門協同，支持智慧營運轉型。



聚焦高階應用拓展

- 先進封裝關鍵製程電漿應用，Hybrid Bonding 前處理製程支援高密度晶片堆疊與異質整合。
- **ABF載板全乾式蝕刻**電漿應用，支援高頻高速與先進封裝需求。
- 拓展**玻璃基板及面板級封裝**應用，開發玻璃蝕刻與表面處理能力。
- 延伸至GaN 表面處理等**第三代半導體**應用，完成模組開發並推進功率元件導入。

布局前瞻綠色技術 (ESG)



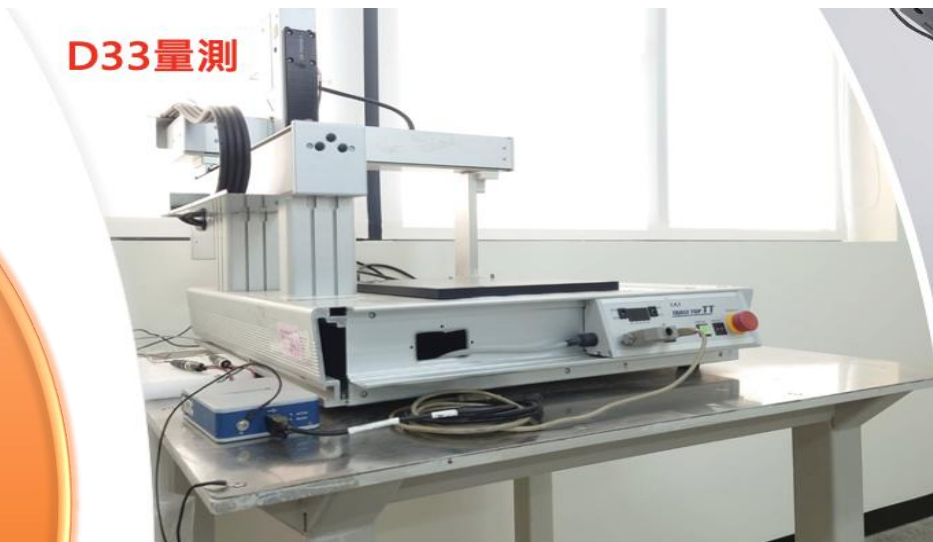
- 電漿全乾法低碳製程，替代傳統濕式製程。

競爭優勢（三）_創造客戶價值



分析實驗室的構建

D33量測



SEM&EDX



白光干涉儀



A-Step



競爭優勢（四）_國際市場佈局與策略客戶合作

產品已成功導入 美國半導體領導大廠I公司、日本IC載板I大廠、通訊Q大廠、日本電子H集團 等國際大廠之量產製程，建立技術信任門檻，同時積極佈局日本、美國、歐洲與東南亞市場，加速客戶採購決策。

時間	合作企業	合作內容	暉盛貢獻	成果
2002年	旭象科技 (聯測投資)	開發電漿鑽孔機	開發真空電漿專孔技術 (Plasma Driller)，取代雷射鑽孔。	成功導入鑽孔設備取代雷射，降低生產成本，並催生後續用於PCB去膠渣的真空電漿平台架構，奠定高密度電漿設備及電漿去膠渣機發展的基礎與聯測的入股。
2004年	IC載板 U公司	開發大氣電漿 in-line 清潔設備	開發in-line式常壓電漿設備取代濕式化學處理，實現批次自動化連線處理。	產品良率顯著提升、清潔效果穩定、製程耗能下降，開啟大氣電漿平台的多產業應用。
2010年	半導體 I大廠	開發ABF電漿改質技術，並取得半導體I大廠認證	提供高均勻性真空電漿平台，針對 ABF 表面進行改質與粗化控制。	取得 I大廠 認證，導入先進封裝基板處理產線，2022~2023年大幅放量出貨ABF專用機種以及目前ABF載板蝕刻市場的拓展。
2011年	IC載板 U公司	開發in-line 真空電漿機	從batch式升級為連續式真空電漿平台，解決處理均勻性的問題。	該系統亦獲I大廠評估採納，強化暉盛與I大廠合作關係，同時造就日本IC載板I大廠及台灣PCB Z集團銷售合作。
2012年	PCB M公司	開發超薄FPC卷對卷電漿設備	開發高速真空卷對卷平台，高密度電漿源進行低溫處理。	除膠殘留率大幅降低，推升FPC與壓電材料應用，此也替未來卷對卷壓電材料的技術發展奠定基礎；同時也深化與日本H集團投資的合作。
2018年	通訊 Q大廠	開發PVDF 指紋晶片電漿極化設備	短脈衝高電場電漿處理，調整分子取向。	導入手機指紋晶片封裝，設備已擴銷至Q大廠之中系與美系代工廠。
2019年	車用電子 D 公司	開發高密度電漿 (ICP) 於Si 蝕刻設備	ICP RIE 在Si wafer上蝕刻SiO ₂ 。	開始暉盛各式高密度電漿的開發 (ICP、MW等) 以及半導體市場的應用。
2024年	晶圓代工 T大廠	開發混和鍵合(Hybrid Bonding)技術應用於立體封裝	以中頻介電屏障放電(DBD)大氣電漿實現大面積金屬還原。	預計2026年完成驗證並開始少量導入，2027年起進入量產供應。

國際認證/技術專利



- PLASMA DESMEAR MACHINE
(NEMST-DP2002, NEMST-DP2002L,
NEMST-D2002R2R_26, NEMST-D2002R2R_52,
NEMST-D2002ILD, NEMST-D2002ILDV, NEMST-
D2002ILS, NEMST-D2002ILSV, NEMST-D2002ILDRD)



- In-Line Plasma Desmear Machine Dual
Chamber (NEMST-D2002IL, NEMST-D2002ILDIII)
- In-Line Plasma Desmear Machine (NEMST-
D2002ILDIV_With EFEM)
- Plasma Desmear Machine (NEMST-D2002L)
- Arc Jet Type Atmospheric Plasma Cleaner_ with
EFEM (NEMST-Jet2008I_7XII)



國際認證/技術專利



類型	專利名稱	對應之核心技術
新型	空氣清淨機	高效電漿火焰技術
發明	自動化線上電漿製程系統	RIE 電漿蝕刻系統
發明	電漿晶圓清潔機及使用其清潔晶圓的方法	ICP-RIE 電漿蝕刻系統
發明	卷對卷式電漿去膠渣機	ICP-RIE 電漿蝕刻系統
發明	壓電材料卷對卷極化設備	常壓電漿極化
發明	壓電材料極化設備	常壓電漿極化
發明	氣體分解裝置(一)	高效電漿火焰技術
發明	氣體分解裝置(二)	高效電漿火焰技術
發明	感應耦合電漿蝕刻設備及其多迴圈式電極	ICP-RIE 電漿蝕刻系統
發明	電漿晶圓清潔設備	高效電漿火焰技術
申請中	氣體分解裝置(三)	大氣電漿處理技術
申請中	真空電漿蝕刻之薄板定位裝置	ICP-RIE 電漿蝕刻系統
申請中	電漿氧化還原裝置及方法	Hybrid Bonding(混合鍵合技術) - 大氣電漿處理技術

終端使用者

KINWONG
景旺电子

CHIMEI

Kingston
金士頓科技

JCET



OSE
A partner you can count on

GHPT

KONICA MINOLTA

嘉联益科技
Career

AUO

Fujikura



VISHAY

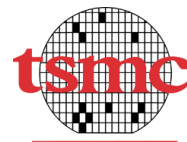
ASE GROUP
日月光集團

IBIDEN

LITEON

MekTEC

GARMIN



Qualcomm

HITACHI
Inspire the Next

TRULYOPTO
信利光電股份有限公司

臻鼎科技集團
Zhen Ding Tech. Group



Unimicron
欣興電子

AT&S

Lextar
隆達電子

INNOLUX
群創光電

Unitech

景碩科技

京东方
BOE

SCC
深南电路

WNC
Wistron NeWeb Corp.

TXC
台灣晶技股份有限公司
TXC Corporation

win
穩懋半導體

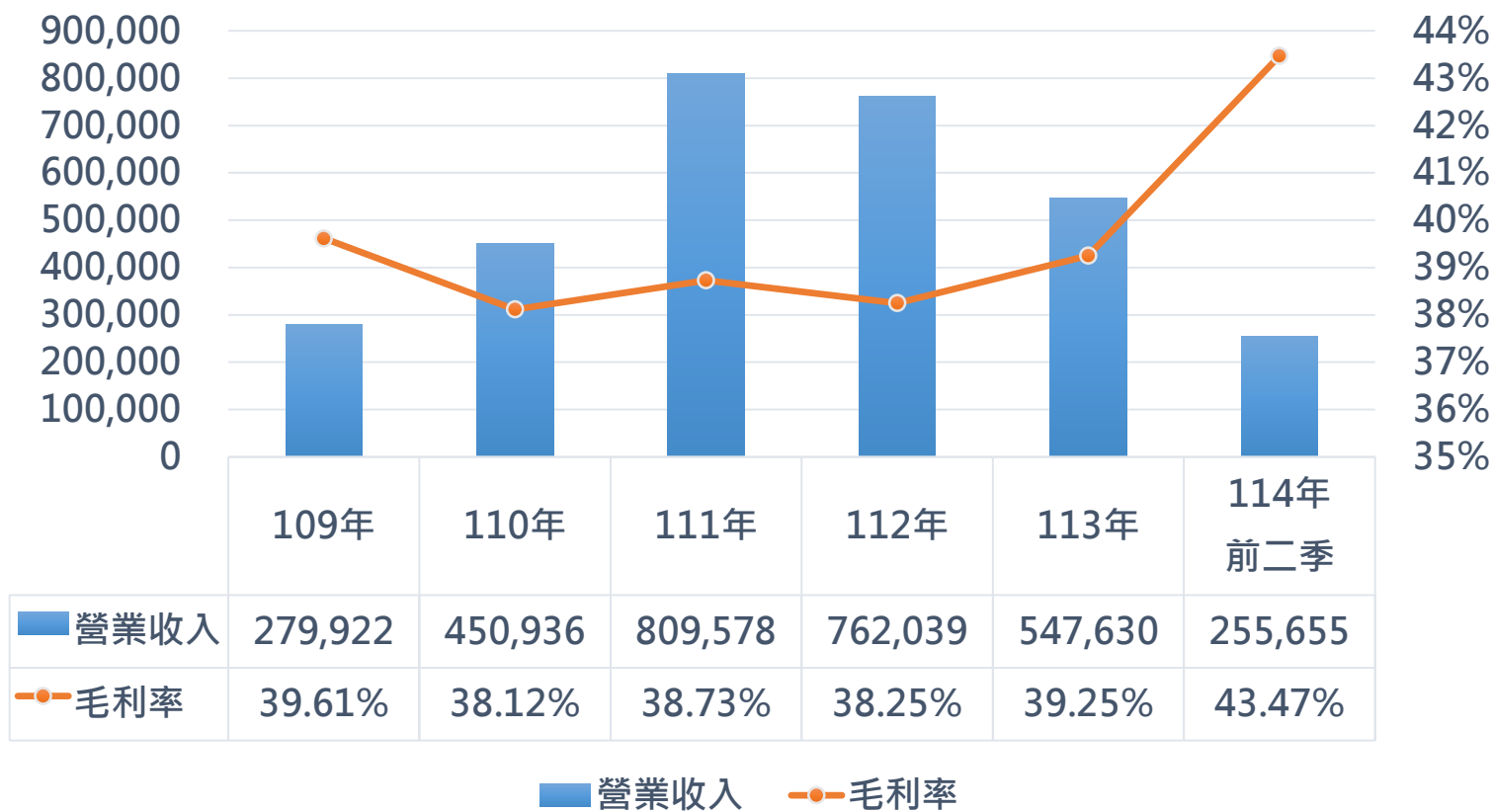
GIS

DENSO

營運實績

營收狀況

單位：新台幣千元

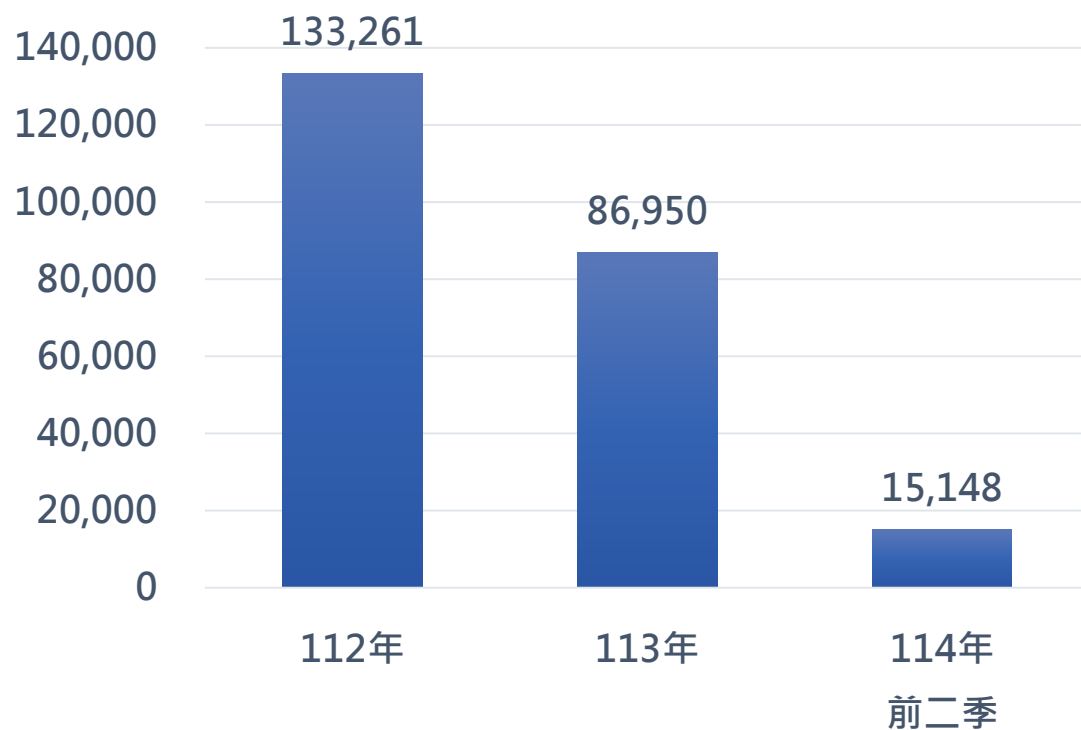


Source：109年至113年度各期經會計師查核簽證之財務報告
114年第二季為會計師核閱之財務報告。

獲利情形

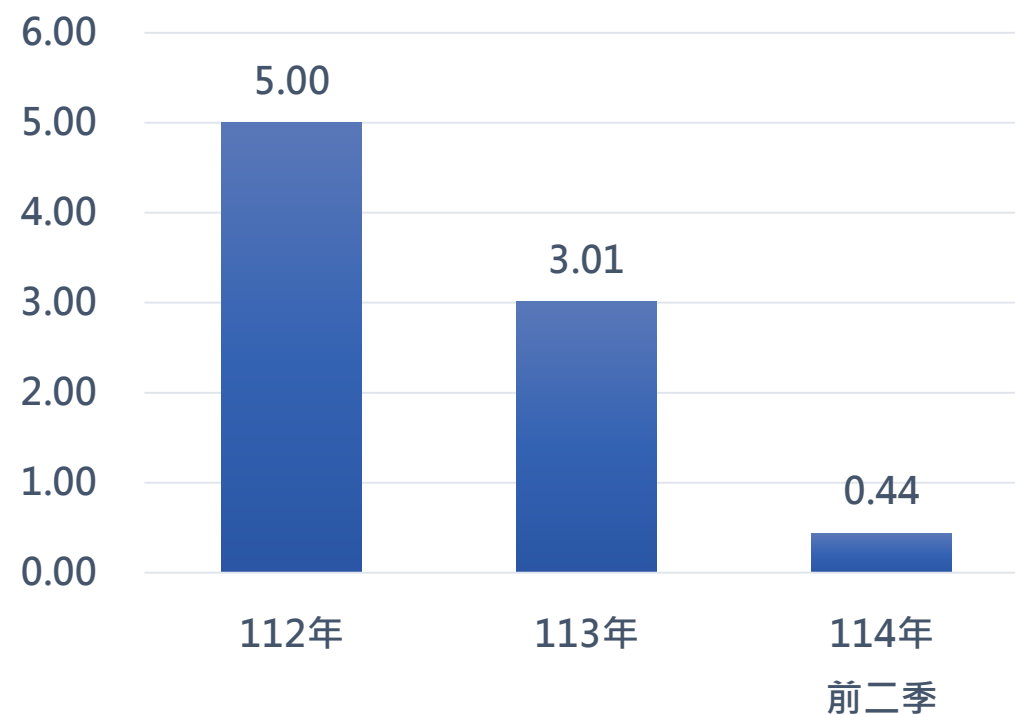
稅後淨利(淨利歸屬母公司)

單位：新台幣千元



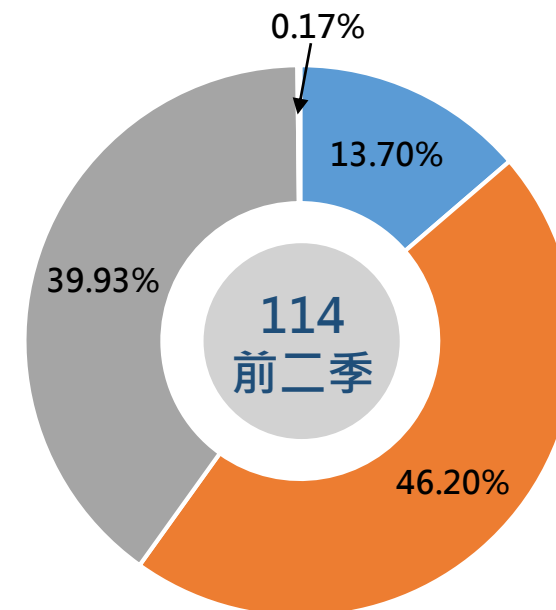
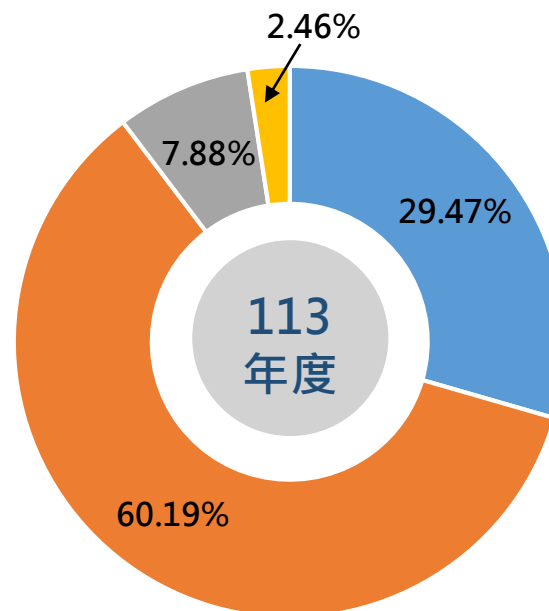
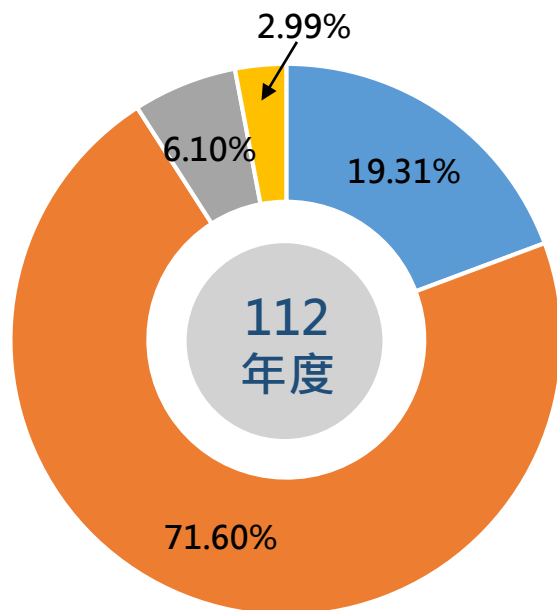
每股盈餘

單位：新台幣元



Source：112年度與113年度經會計師查核簽證之財務報告，114年第二季為經會計師核閱之財務報告。

產品應用別比重



IC載板

半導體

PCB

其他

公司長期願景及未來目標

發展技術

深孔蝕刻用ICP-RIE

高功率ICP-RIE機台

300 mm晶圓電漿拋光減薄機台

ECR高密度電漿機台

寬幅(320 mm)大氣電漿氧化銅去除機台

製程應用

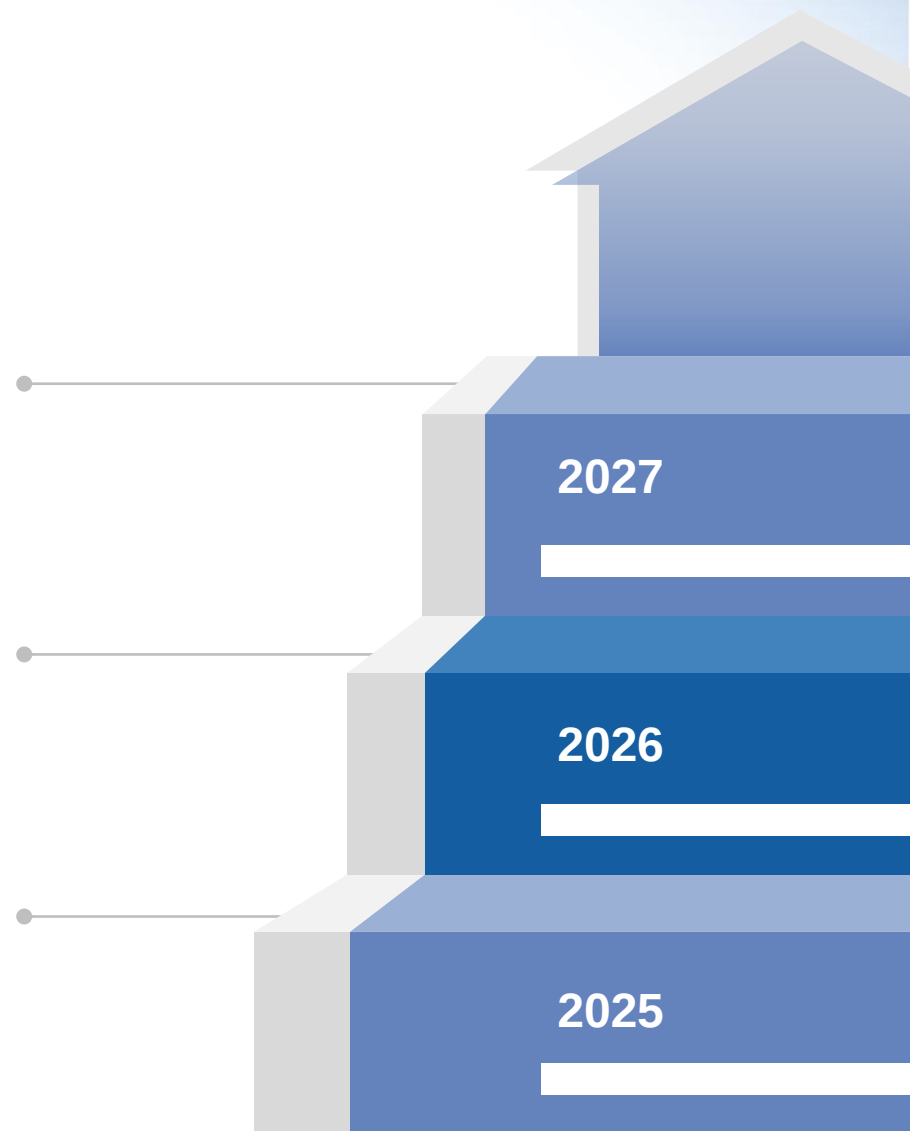
矽通孔、載板通孔、Micro LED巨量轉移

3D IC、Chiplet架構、高效能運算及AI晶片

多晶片堆疊、3D IC與先進封裝

Fan-out、SoIC封裝、3D堆疊製程清潔

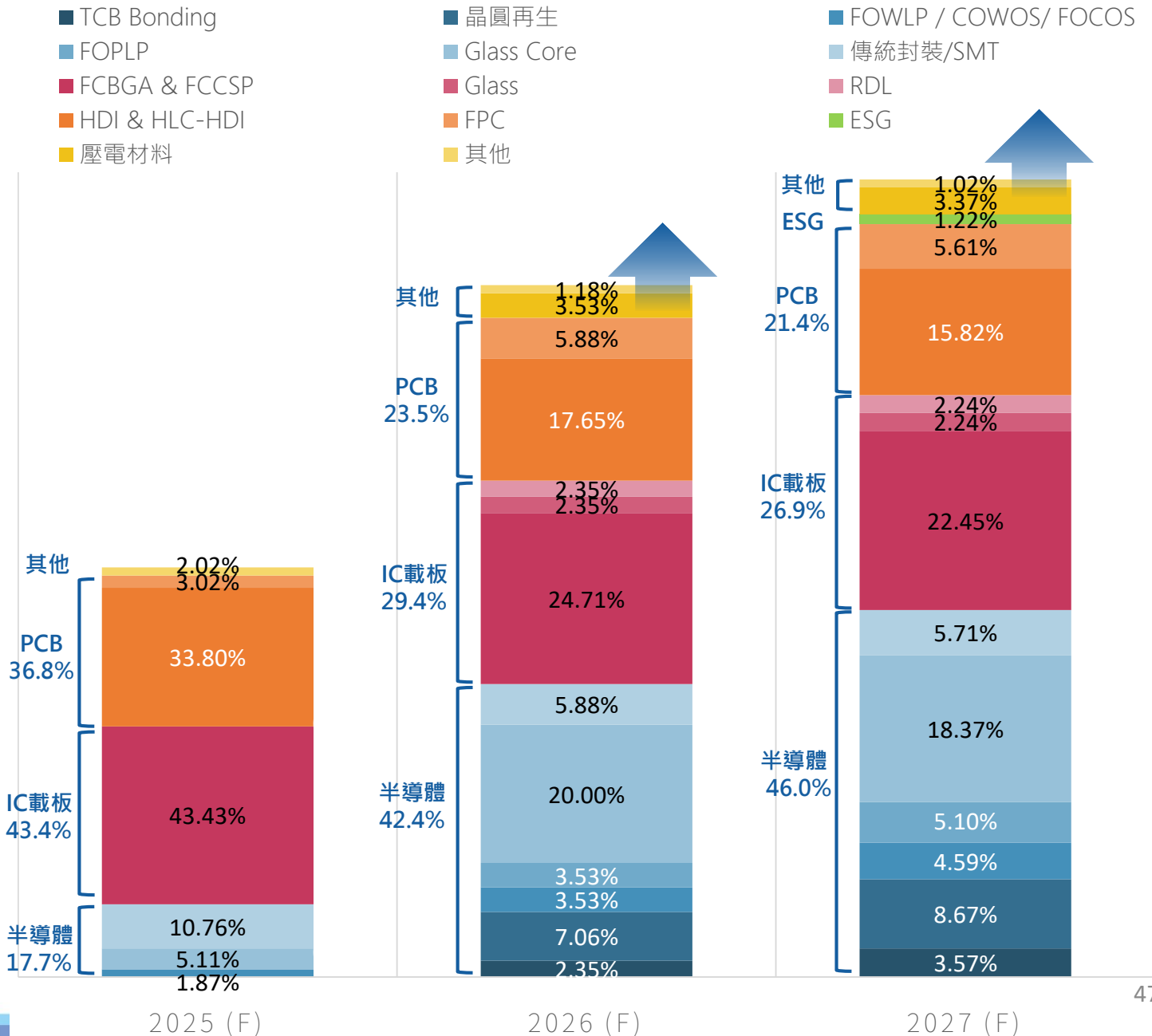
3D IC、Chiplet架構、高效能運算及AI晶片



公司長期願景及未來目標

產品地圖

半導體	晶圓製造	TCB Bonding
		晶圓再生
	先進封裝	FOWLP / COWOS/ FOCOS
		FOPLP
		Glass Core
IC 載板	IC 載板	傳統封裝/SMT
		FCBGA & FCCSP
		Glass
		RDL
PCB	PCB	HDI & HLC-HDI
		FPC
ESG	ESG	ESG
其他	壓電材料	壓電材料
	其他	其他



公司治理與企業社會責任

公司治理

➤ 治理架構

- 建立透明、高效的治理架構，保障企業穩定發展與股東權益。
- 採取「董事會監督、專業經理人經營」模式。

➤ 制度與規範

- 依循台灣證交所公司治理守則。
- 強化內部控制與風險管理。
- 定期財務揭露、審計制度、內部稽核，確保決策透明、合法、符合法規。

➤ 人才政策

- 實施 ESOP 員工持股計畫。
- 目的：提升企業競爭力與員工忠誠度。

落實公司治理

企業社會責任

➤ 核心理念

- 響應 ESG (環境、社會、治理) 。
- 推動綠色製程、降低碳排放與能源浪費。
- 建立「環境友善、社區共好」永續文化。

➤ 具體行動

- 優化製程，減少廢氣與廢水排放。
- 舉辦員工與親子關懷活動，提升幸福感與歸屬感。
- 邀請偏鄉學童、銀髮族參與公益，促進跨世代互動。
- 贊助社區活動、協助弱勢團體，積極回饋社會。
- 與醫療單位合作，舉辦教育講座，推廣永續與環保理念。

深耕在地，共築永續福祉



永續經營

- 強化管理及公司治理，
提升營運績效
- 創造股東價值



- 延攬、培育及留用優秀人才
- 多元化籌資管道

- 增進公司聲譽與客戶信任度
- 擴大業績與競爭力

Thank you!